

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2004 年 10 月 14 日 (14.10.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/088686 A1

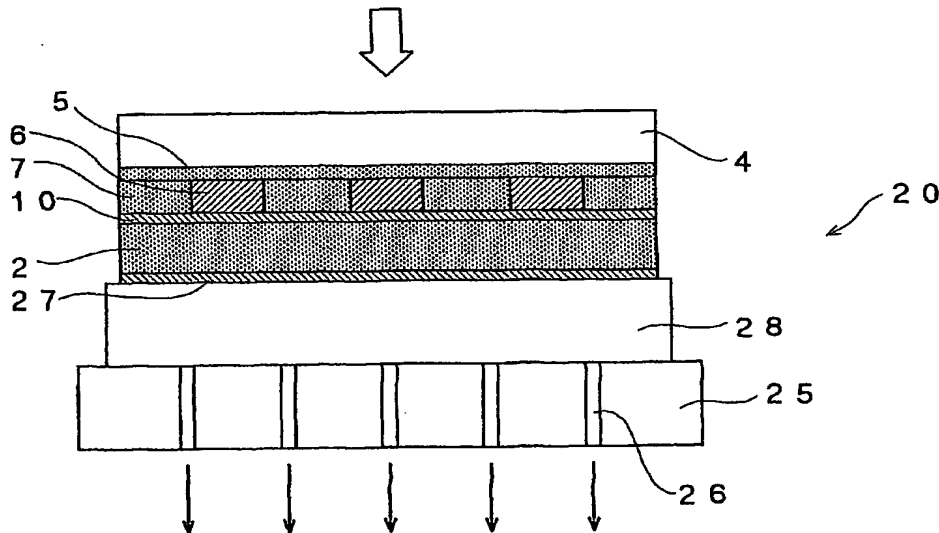
- (51) 国際特許分類⁷: H01G 4/12, 4/30
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/004730
- (22) 国際出願日: 2004 年 3 月 31 日 (31.03.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2003-96290 2003 年 3 月 31 日 (31.03.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): TDK
株式会社 (TDK CORPORATION) [JP/JP]; 〒103-8272
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 唐津 真弘

(KARATSU, Masahiro) [JP/JP]; 〒103-8272 東京都
中央区日本橋一丁目13番1号 TDK株式会社
内 Tokyo (JP). 佐藤 茂樹 (SATO, Shigeki) [JP/JP]; 〒
103-8272 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
TDK株式会社内 Tokyo (JP). 金杉 将明 (KANA-
SUGI, Masaaki) [JP/JP]; 〒103-8272 東京都中央区日
本橋一丁目13番1号 TDK株式会社内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 大石 皓一, 外(OISHI, Koichi et al.); 〒101-
0063 東京都千代田区神田淡路町一丁目4番1号友
泉淡路町ビル8階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,
NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,
[続葉有]

(54) Title: PRODUCTION METHOD FOR LAMINATED CERAMIC ELECTRONIC COMPONENT

(54) 発明の名称: 積層セラミック電子部品の製造方法



(57) Abstract: A production method for a laminated ceramic electronic component capable of laminating a desired number of laminate units efficiently to produce a laminated ceramic electronic component while positively preventing damage to laminate units each including a ceramic green sheet and an electrode layer. The production method comprises the step of layering a plurality of laminate units each consisting of a release layer, an electrode layer and a ceramic green sheet on a support sheet in the order mentioned, wherein laminate units are positioned so that the surface of the green sheet of a laminate unit contacts the surface of an adhesive layer formed on the surface of a support in such a manner that the adhesive strength between a laminate unit and the support is higher than that between a support sheet and a release layer and lower than that between it and a ceramic green sheet, and they are pressurized to layer laminate units on the support.

[続葉有]



SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG,
CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が
可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL,
SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG,
KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY,
CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC,

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約: 本発明は、セラミックグリーンシートと電極層を含む積層体ユニットの損傷を確実に防止しつつ、効率的に、所望の数の積層体ユニットを積層して、積層セラミック電子部品を製造することができる積層セラミック電子部品の製造方法を提供することを目的とするものである。本発明にかかる積層セラミック電子部品の製造方法は、支持シート上に、剥離層、電極層およびセラミックグリーンシートが、この順に、積層された複数の積層体ユニットを積層するステップを含み、支持体との間の接着強度が、支持シートと剥離層との間の接着強度よりも強く、かつ、それとセラミックグリーンシートとの間の接着強度よりも弱くなるように、支持体の表面に形成された粘着層の表面に、積層体ユニットのセラミックグリーンシートの表面が接触するように、積層体ユニットを位置決めして、加圧し、支持体上に、積層体ユニットを積層するように構成されている。

明細書

積層セラミック電子部品の製造方法

5 技術分野

本発明は、積層セラミック電子部品の製造方法に関するものであり、さらに詳細には、セラミックグリーンシートと電極層を含む積層体ユニットの損傷を確実に防止しつつ、効率的に、所望の数の積層体ユニットを積層して、積層セラミック電子部品を製造することができる積層セラミック電子部品の製造方法に関するものである。

従来の技術

近年、各種電子機器の小型化にともなって、電子機器に実装される電子部品の小型化および高性能化が要求されるようになっており、積層セラミックコンデンサなどの積層セラミック電子部品においても、積層数の増加、積層単位の薄層化が強く要求されている。

積層セラミックコンデンサによって代表される積層セラミック電子部品を製造するには、まず、セラミック粉末と、アクリル樹脂、ブチラール樹脂などのバインダと、フタル酸エステル類、グリコール類、アジピン酸、リン酸エステル類などの可塑剤と、トルエン、メチルエチルケトン、アセトンなどの有機溶媒を混合分散して、誘電体ペーストを調製する。

次いで、誘電体ペーストを、エクストルージョンコーターやグラビアコーターを用いて、ポリエチレンテレフタレート（PET）やポリプロピレン（PP）などによって形成された支持シート上に、塗布し、加熱して、塗膜を乾燥させ、セラミックグリーンシートを作製する。

さらに、セラミックグリーンシート上に、ニッケルなどの電極ペーストを、スクリーン印刷機などによって、所定のパターンで、印刷し、乾燥させて、電極層を形成する。

電極層が形成されると、電極層が形成されたセラミックグリーンシ

ートを支持シートから剥離して、セラミックグリーンシートと電極層を含む積層体ユニットを形成し、所望の数の積層体ユニットを積層して、加圧し、得られた積層体を、チップ状に切断して、グリーンチップを作製する。

- 5 最後に、グリーンチップからバインダを除去して、グリーンチップを焼成し、外部電極を形成することによって、積層セラミックコンデンサなどの積層セラミック電子部品が製造される。

- 電子部品の小型化および高性能化の要請によって、現在では、積層セラミックコンデンサの層間厚さを決定するセラミックグリーンシート
- 10 の厚さを $3\ \mu\text{m}$ あるいは $2\ \mu\text{m}$ 以下にすることが要求され、300以上のセラミックグリーンシートと電極層を含む積層体ユニットを積層することが要求されている。

- その結果、従来のように、積層セラミックコンデンサの外層上に、必要な数のセラミックグリーンシートと電極層を含む積層体ユニット
- 15 を積層する場合には、外層上に、最初に積層された積層体ユニットは、300回以上も加圧されることになり、損傷を受けやすいため、積層体ユニットを、たとえば、50枚ずつ、積層して、複数の積層体ブロックを形成し、複数の積層体ブロックを、積層セラミックコンデンサの外層上に、積層することが必要になる。

- 20 しかしながら、積層セラミックコンデンサの外層上に、必要な数のセラミックグリーンシートと電極層を含む積層体ユニットを積層する場合には、外層を金型上に固定して、積層体ユニットを積層することができたが、積層体ユニットどうしと積層する場合には、セラミックグリーンシートと電極層を含む積層体ユニットを金型上に固定して、
- 25 積層体ユニットを積層すると、積層体ユニットが損傷されるおそれが高いという問題があった。

発明の開示

- したがって、本発明は、セラミックグリーンシートと電極層を含む
- 30 積層体ユニットの損傷を確実に防止しつつ、効率的に、所望の数の積

層体ユニットを積層して、積層セラミック電子部品を製造することができる積層セラミック電子部品の製造方法を提供することを目的とするものである。

本発明のかかる目的は、支持シート上に、剥離層、電極層およびセラミックグリーンシートが、この順に、積層された複数の積層体ユニットを積層して、積層セラミック電子部品を製造する方法であって、支持体との間の接着強度が、前記支持シートと前記剥離層との間の接着強度よりも強く、かつ、それと前記セラミックグリーンシートとの間の接着強度よりも弱くなるように、前記支持体の表面に形成された粘着層の表面に、前記積層体ユニットの前記セラミックグリーンシートの表面が接触するように、前記積層体ユニットを位置決めして、加圧し、前記支持体上に、前記積層体ユニットを積層することを特徴とする積層セラミック電子部品の製造方法によって達成される。

本発明によれば、支持シート上に、剥離層、電極層およびセラミックグリーンシートが積層された積層体ユニットが、支持体の表面に、支持体との間の接着強度が、支持シートと剥離層との間の接着強度よりも強く、かつ、それとセラミックグリーンシートとの間の接着強度よりも弱くなるように、形成された粘着層上に、積層体ユニットのセラミックグリーンシートの表面が、粘着層に面接触するように、位置決めされ、加圧されて、支持体上に積層されるように構成されているから、所望の数の積層体ユニットを積層して、積層セラミック電子部品を製造する際に、積層体ユニットが損傷されることを効果的に防止することが可能になる。

また、本発明によれば、粘着層は、支持体との間の接着強度が、支持シートと剥離層との間の接着強度よりも強くなるように、支持体の表面に形成されているから、支持体上に積層された積層体ユニットの剥離層から、支持シートを容易に剥離することができ、支持体上に積層された積層体ユニットの剥離層上に、効率的に、新たな積層体ユニットを積層することが可能になる。

さらに、本発明によれば、粘着層は、支持体との間の接着強度が、

粘着層とセラミックグリーンシートとの間の接着強度よりも弱くなるように、支持体の表面に形成されているから、支持体上に積層された積層体ユニットの剥離層から、支持シートを剥離した後に、セラミックグリーンシートの表面に、接着層が形成された積層体ユニットを、

5 支持体上に積層された積層体ユニットの剥離層上に、接着層を介して、積層するステップを繰り返して、所定の数の積層体ユニットが、支持体上に積層された積層体ブロックを形成し、積層セラミックコンデンサの外層などの上に、積層体ブロックを積層した後に、粘着層がセラミックグリーンシートに接着したまま、支持体のみを粘着層から剥離

10 させて、取り除くことができ、したがって、外層などの上に積層された積層体ブロック上に、さらに、新たな積層体ブロックを積層するときに、新たな積層体ブロックに、接着層を形成する必要がないから、効率的に、積層セラミック電子部品を製造することが可能になる。

本発明において、セラミックグリーンシートを形成するために用い

15 る誘電体ペーストは、通常、誘電体原料と、有機溶剤中にバインダを溶解させた有機ビヒクルを混練して、調製される。

誘電体原料としては、複合酸化物や酸化物となる各種化合物、たとえば、炭酸塩、硝酸塩、水酸化物、有機金属化合物などから適宜選択され、これらを混合して、用いることができる。誘電体原料は、通常、

20 平均粒子径が約 $0.1 \mu\text{m}$ ないし約 $3.0 \mu\text{m}$ 程度の粉末として用いられる。誘電体原料の粒径は、セラミックグリーンシートの厚さより小さいことが好ましい。

有機ビヒクルに用いられるバインダは、とくに限定されるものではなく、エチルセルロース、ポリビニルブチラール、アクリル樹脂などの通常

25 の各種バインダが用いることができるが、セラミックグリーンシートを薄層化するためには、ポリビニルブチラールなどのブチラール系樹脂が、好ましく用いられる。

有機ビヒクルに用いられる有機溶剤も、とくに限定されるものではなく、テルピネオール、ブチルカルビトール、アセトン、トルエンな

30 どの有機溶剤が用いられる。

本発明において、誘電体ペーストは、誘電体原料と、水中に水溶性バインダを溶解させたビヒクルを混練して、生成することもできる。

水溶性バインダは、とくに限定されるものではなく、ポリビニルアルコール、メチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、水溶性
5 アクリル樹脂、エマルジョンなどが用いられる。

誘電体ペースト中の各成分の含有量は、とくに限定されるものではなく、たとえば、約 1 重量%ないし約 5 重量%のバインダと、約 10 重量%ないし約 50 重量%の溶剤を含むように、誘電体ペーストを調製することができる。

10 誘電体ペースト中には、必要に応じて、各種分散剤、可塑剤、誘電体、副成分化合物、ガラスフリット、絶縁体などから選択される添加物が含有されていてもよい。誘電体ペースト中に、これらの添加物を添加する場合には、総含有量を、約 10 重量%以下にすることが望ましい。バインダ樹脂として、ブチラール系樹脂を用いる場合には、可
15 塑剤の含有量は、バインダ樹脂 100 重量部に対して、約 25 重量部ないし約 100 重量部であることが好ましい。可塑剤が少なすぎると、生成されたセラミックグリーンシートが脆くなる傾向があり、多すぎると、可塑剤が滲み出して、取り扱いが困難になり、好ましくない。

本発明において、セラミックグリーンシートは、誘電体ペーストを、
20 第一の支持シート上に塗布し、乾燥して、作製される。

誘電体ペーストは、エクストルージョンコーターやワイヤーバーコーターなどを用いて、第一の支持シート上に塗布され、塗膜が形成される。

第一の支持シートとしては、たとえば、ポリエチレンテレフタレートフィルムなどが用いられ、剥離性を改善するために、その表面に、シリコン樹脂、アルキド樹脂などがコーティングされる。第一の支持シートの厚さは、とくに限定されるものではないが、好ましくは、約
25 5 μm ないし約 100 μm である。

こうして形成された塗膜は、たとえば、約 50 $^{\circ}\text{C}$ ないし約 100 $^{\circ}\text{C}$ の温度で、約 1 分ないし約 20 分にわたって、乾燥され、支持シ
30

ト上に、セラミックグリーンシートが形成される。

本発明において、乾燥後におけるセラミックグリーンシートの厚さが $3\ \mu\text{m}$ 以下であることが好ましく、さらに好ましくは、 $1.5\ \mu\text{m}$ 以下である。

- 5 本発明において、積層体ユニットの電極層を形成するにあたっては、第一の支持シートとは別に、第二の支持シートが準備され、第二の支持シート上に、スクリーン印刷機やグラビア印刷機などの印刷機を用いて、電極ペーストが印刷されて、電極層が形成される。

- 10 第二の支持シートとしては、たとえば、ポリエチレンテレフタレートフィルムなどが用いられ、剥離性を改善するために、その表面に、シリコン樹脂、アルキド樹脂などがコーティングされる。第二の支持シートの厚さは、とくに限定されるものではなく、セラミックグリーンシートが形成される支持シートの厚さと同じであっても、異なってもよいが、好ましくは、約 $5\ \mu\text{m}$ ないし約 $100\ \mu\text{m}$ である。

- 15 本発明において、第二の支持シート上に、電極層を形成するのに先立って、まず、誘電体ペーストが調製され、第二の支持シート上に塗布されて、剥離層が、第二の支持シート上に形成される。

- 20 剥離層を形成するための誘電体ペーストは、好ましくは、セラミックグリーンシートに含まれている誘電体と同一組成の誘電体の粒子を含んでいる。

剥離層を形成するための誘電体ペーストは、誘電体粒子以外に、バインダと、任意成分として、可塑剤および剥離剤とを含んでいる。誘電体粒子の粒径は、セラミックグリーンシートに含まれる誘電体粒子の粒径と同じでもよいが、より小さいことが好ましい。

- 25 バインダとしては、たとえば、アクリル樹脂、ポリビニルブチラール、ポリビニルアセタール、ポリビニルアルコール、ポリオレフィン、ポリウレタン、ポリスチレン、または、これらの共重合体、または、これらのエマルジョンを用いることができる。

- 30 剥離層を形成するための誘電体ペーストに含まれているバインダは、セラミックグリーンシートに含まれているバインダと同系であっても、

同系でなくてもよいが、同系のバインダであることが好ましい。

- 剥離層を形成するための誘電体ペーストは、誘電体粒子 100 重量部に対して、好ましくは、約 2.5 重量部ないし約 200 重量部、さらに好ましくは、約 5 重量部ないし約 30 重量部、とくに好ましくは、
5 約 8 重量部ないし約 30 重量部のバインダを含んでいる。

- 可塑剤は、とくに限定されるものではなく、たとえば、フタル酸エステル、アジピン酸、リン酸エステル、グリコール類などを挙げることができる。剥離層を形成するための誘電体ペーストに含まれる可塑剤は、セラミックグリーンシートに含まれる可塑剤と同系であっても、
10 同系でなくてもよい。

剥離層を形成するための誘電体ペーストは、バインダ 100 重量部に対して、約 0 重量部ないし約 200 重量部、好ましくは、約 20 重量部ないし約 200 重量部、さらに好ましくは、約 50 重量部ないし約 100 重量部の可塑剤を含んでいる。

- 15 剥離層を形成するための誘電体ペーストに含まれる剥離剤は、とくに限定されるものではなく、たとえば、パラフィン、ワックス、シリコン油などを挙げることができる。

- 剥離層を形成するための誘電体ペーストは、バインダ 100 重量部に対して、約 0 重量部ないし約 100 重量部、好ましくは、約 2 重量部ないし約 50 重量部、さらに好ましくは、約 5 重量部ないし約 20 重量部の剥離剤を含んでいる。
20

- 本発明において、剥離層に含まれる誘電体に対するバインダの含有割合が、セラミックグリーンシートに含まれる誘電体に対するバインダの含有割合と同等、あるいは、それよりも低いことが好ましい。また、剥離層に含まれる誘電体に対する可塑剤の含有割合が、セラミックグリーンシートに含まれる誘電体に対する可塑剤の含有割合と同等、
25 あるいは、高いことが好ましい。さらに、剥離層に含まれる誘電体に対する離型剤の含有割合が、セラミックグリーンシートに含まれる誘電体に対する離型剤の含有割合よりも高いことが好ましい。

- 30 このような組成を有する剥離層を形成することにより、セラミック

グリーンシートをきわめて薄層化しても、剥離層の強度を、グリーンシートの破壊強度よりも低くすることができ、第二の支持シートを剥離する際に、セラミックグリーンシートが破壊されることを確実に防止することが可能になる。

- 5 剥離層は、ワイヤーバーコーターなどを用いて、第二の支持シート上に、誘電体ペーストを塗布することによって、形成される。

剥離層の厚さは、その上に形成される電極層の厚さ以下であることが好ましく、好ましくは、電極層の厚さの約60%以下、さらに好ましくは、電極層の厚さの約30%以下である。

- 10 剥離層の形成後、剥離層は、たとえば、約50℃ないし約100℃で、約1分ないし約10分にわたって、乾燥される。

剥離層が乾燥された後、剥離層の表面上に、焼成後に、内部電極層を構成する電極層が、所定パターンで形成される。

- 15 本発明において、電極層を形成するために用いられる電極ペーストは、各種導電性金属や合金からなる導電体材料、焼成後に、各種導電性金属や合金からなる導電体材料となる各種酸化物、有機金属化合物、または、レジネートなどと、有機溶剤中にバインダを溶解させた有機ビヒクルとを混練して、調製される。

- 20 電極ペーストを製造する際に用いる導電体材料としては、Ni、Ni合金あるいはこれらの混合物が、好ましく用いられる。導電体材料の形状は、とくに限定されるものではなく、球状でも、鱗片状でも、あるいは、これらの形状のものが混合されていてもよい。また、導電体材料の平均粒子径は、とくに限定されるものではないが、通常、約0.1μmないし約2μm、好ましくは、約0.2μmないし約1μmの導電性材料が用いられる。

- 25 有機ビヒクルに用いられるバインダは、とくに限定されるものではなく、エチルセルロース、アクリル樹脂、ポリビニルブチラール、ポリビニルアセタール、ポリビニルアルコール、ポリオレフィン、ポリウレタン、ポリスチレン、あるいは、これらの共重合体などを用いることができるが、とくに、ポリビニルブチラールなどのブチラール
- 30

系バインダが好ましく用いられる。

電極ペーストは、導電体材料 100 重量部に対して、好ましくは、約 2.5 重量部ないし約 20 重量部のバインダを含んでいる。

溶剤としては、たとえば、テルピネオール、ブチルカルビトール、
5 ケロシンなど、公知の溶剤を用いることができる。溶剤の含有量は、電極ペースト全体に対して、好ましくは、約 20 重量%ないし約 55 重量%である。

接着性を改善するために、電極ペーストが、可塑剤を含んでいることが好ましい。

10 電極ペーストに含まれる可塑剤は、とくに限定されるものではなく、たとえば、フタル酸ベンジルブチル (BBP) などのフタル酸エステル、アジピン酸、リン酸エステル、グリコール類などを挙げることができる。電極ペーストは、バインダ 100 重量部に対して、好ましくは、約 10 重量部ないし約 300 重量部、さらに好ましくは、約 10 重量
15 部ないし約 200 重量部の可塑剤を含んでいることが好ましい。

可塑剤の添加量が多すぎると、電極層の強度が著しく低下する傾向があり、好ましくない。

電極層は、スクリーン印刷機やグラビア印刷機などの印刷機を用いて、第二の支持シート上に形成された剥離層の表面に、電極ペースト
20 を印刷することによって、形成される。

電極層の厚さは、約 0.1 μm ないし約 5 μm の厚さに形成されることが好ましく、より好ましくは、約 0.1 μm ないし約 1.5 μm である。

本発明において、好ましくは、第二の支持シート上に形成された剥
25 離層の表面の電極層が形成されていない部分に、さらに、スクリーン印刷機やグラビア印刷機などの印刷機を用いて、電極層と相補的なパターンで、誘電体ペーストが印刷されて、スペーサ層が形成される。

電極層の形成に先立って、第二の支持シート上に形成された剥離層の表面に、電極層と相補的なパターンで、スペーサ層を形成すること
30 もできる。

本発明において、スペーサ層を形成するために用いる誘電体ペーストは、セラミックグリーンシートを形成するための誘電体ペーストと同様にして、調製される。

5 スペーサ層を形成するための誘電体ペーストは、好ましくは、セラミックグリーンシートに含まれている誘電体と同一組成の誘電体の粒子を含んでいる。

10 スペーサ層を形成するための誘電体ペーストは、誘電体粒子以外に、バインダと、任意成分として、可塑剤および剥離剤とを含んでいる。誘電体粒子の粒径は、セラミックグリーンシートに含まれる誘電体粒子の粒径と同じでもよいが、より小さいことが好ましい。

バインダとしては、たとえば、アクリル樹脂、ポリビニルブチラール、ポリビニルアセタール、ポリビニルアルコール、ポリオレフィン、ポリウレタン、ポリスチレン、または、これらの共重合体、または、これらのエマルジョンを用いることができる。

15 スペーサ層を形成するための誘電体ペーストに含まれているバインダは、セラミックグリーンシートに含まれているバインダと同系であっても、同系でなくてもよいが、同系であることが好ましい。

20 スペーサ層を形成するための誘電体ペーストは、誘電体粒子100重量部に対して、好ましくは、約2.5重量部ないし約200重量部、さらに好ましくは、約4重量部ないし約15重量部、とくに好ましくは、約6重量部ないし約10重量部のバインダを含んでいる。

25 スペーサ層を形成するための誘電体ペーストに含まれている可塑剤は、とくに限定されるものではなく、たとえば、フタル酸エステル、アジピン酸、リン酸エステル、グリコール類などを挙げることができる。スペーサ層を形成するための誘電体ペーストに含まれる可塑剤は、セラミックグリーンシートに含まれる可塑剤と同系であっても、同系でなくてもよい。

30 スペーサ層を形成するための誘電体ペーストは、バインダ100重量部に対して、約0重量部ないし約200重量部、好ましくは、約20重量部ないし約200重量部、さらに好ましくは、約50重量部な

いし約 100 重量部の可塑剤を含んでいる。

スペーサ層を形成するための誘電体ペーストに含まれる剥離剤は、とくに限定されるものではなく、たとえば、パラフィン、ワックス、シリコン油などを挙げることができる。

- 5 スペーサ層を形成するための誘電体ペーストは、バインダ 100 重量部に対して、約 0 重量部ないし約 100 重量部、好ましくは、約 2 重量部ないし約 50 重量部、より好ましくは、約 5 重量部ないし約 20 重量部の剥離剤を含んでいる。

- 10 本発明において、電極層およびスペーサ層は、 $0.7 \leq t_s / t_e \leq 1.3$ (t_s は、スペーサ層の厚さであり、 t_e は、電極層の厚さである。) を満たすように形成されることが好ましく、より好ましくは、 $0.8 \leq t_s / t_e \leq 1.2$ 、さらに好ましくは、 $0.9 \leq t_s / t_e \leq 1.2$ を満たすように形成される。

- 15 電極層およびスペーサ層は、たとえば、約 70℃ないし 120℃の温度で、約 5 分ないし約 15 分にわたって、乾燥される。電極層およびスペーサ層の乾燥条件は、とくに限定されるものではない。

セラミックグリーンシートと、電極層およびスペーサ層は、接着層を介して、接着され、接着層を形成するために、第三の支持シートが用意される。

- 20 第三の支持シートとしては、たとえば、ポリエチレンテレフタレートフィルムなどが用いられ、剥離性を改善するために、その表面に、シリコン樹脂、アルキド樹脂などがコーティングされる。第三の支持シートの厚さは、とくに限定されるものではないが、好ましくは、約 5 μm ないし約 100 μm である。

- 25 接着層は、第三の支持シート上に、接着剤溶液が塗布されて、形成される。

本発明において、接着剤溶液は、バインダと、任意成分として、可塑剤、剥離剤および帯電防止剤とを含んでいる。

- 30 接着剤溶液は、セラミックグリーンシートに含まれている誘電体粒子と同一組成の誘電体粒子を含んでいてもよい。接着剤溶液が、誘電

体粒子を含んでいる場合には、誘電体粒子のバインダ重量に対する割合が、セラミックグリーンシートに含まれている誘電体粒子のバインダ重量に対する割合より小さいことが好ましい。

5 接着剤溶液に含まれるバインダは、セラミックグリーンシートを形成するための誘電体ペーストに含まれるバインダと同系であることが好ましいが、セラミックグリーンシートを形成するための誘電体ペーストに含まれるバインダと同系でなくてもよい。

10 接着剤溶液に含まれる可塑剤は、セラミックグリーンシートを形成するための誘電体ペーストに含まれる可塑剤と同系であることが好ましいが、セラミックグリーンシートを形成するための誘電体ペーストに含まれる可塑剤と同系でなくてもよい。

可塑剤の含有量は、バインダ 100 重量部に対して、約 0 重量部ないし約 200 重量部、好ましくは、約 20 重量部ないし約 200 重量部、さらに好ましくは、約 50 重量部ないし約 100 重量部である。

15 本発明において、好ましくは、接着剤溶液は、バインダの 0.01 重量%ないし 15 重量%の帯電防止剤を含み、さらに好ましくは、バインダの 0.01 重量%ないし 10 重量%の帯電防止剤を含んでいる。

20 本発明において、接着剤溶液に含まれる帯電防止剤は、吸湿性を有する有機溶剤であればよく、たとえば、エチレングリコール；ポリエチレングリコール；2-3ブタンジオール；グリセリン；イミダゾリン系界面活性剤、ポリアルキレングリコール誘導体系界面活性剤、カルボン酸アミジン塩系界面活性剤などの両性界面活性剤などが、接着剤溶液に含まれる帯電防止剤として使用することができる。

25 これらの帯電防止剤の中では、少量で、静電気を防止することが可能であるとともに、小さい剥離力で、接着層から、第三の支持シートを剥離することが可能であるため、イミダゾリン系界面活性剤、ポリアルキレングリコール誘導体系界面活性剤、カルボン酸アミジン塩系界面活性剤などの両性界面活性剤が好ましく、イミダゾリン系界面活性剤は、とくに小さな剥離力で、接着層から、第三の支持シートを剥
30 離することができるため、とくに好ましい。

接着剤溶液は、たとえば、パーコータ、エクストルージョンコータ、リバースコータ、ディップコーター、キスコーターなどによって、第三の支持シート上に塗布され、好ましくは、約 $0.02\ \mu\text{m}$ ないし約 $0.3\ \mu\text{m}$ 、より好ましくは、約 $0.02\ \mu\text{m}$ ないし約 $0.1\ \mu\text{m}$ の厚さの接着層が形成される。接着層の厚さが、約 $0.02\ \mu\text{m}$ 未満の場合には、接着力が低下し、一方、接着層の厚さが、約 $0.3\ \mu\text{m}$ を越えると、欠陥（隙間）の発生原因となり、好ましくない。

接着層は、たとえば、室温（ 25°C ）ないし約 80°C の温度で、約 1 分ないし約 5 分にわたって、乾燥される。接着層の乾燥条件は、とくに限定されるものではない。

第三の支持シート上に形成された接着層は、第二の支持シート上に形成された電極層およびスペーサ層の表面に転写される。

接着層の転写にあたっては、接着層が、第二の支持シート上に形成されたスペーサ層および電極層の表面に接触した状態で、約 40°C ないし約 100°C の温度下で、接着層と、電極層およびスペーサ層とが、約 $0.2\ \text{MPa}$ ないし約 $15\ \text{MPa}$ の圧力で、好ましくは、約 $0.2\ \text{MPa}$ ないし約 $6\ \text{MPa}$ の圧力で、加圧されて、接着層が、電極層およびスペーサ層の表面上に接着され、その後、第三の支持シートが接着層から剥離される。

接着層を、電極層およびスペーサ層の表面に転写するにあたっては、電極層およびスペーサ層が形成された第二の支持シートと、接着層が形成された第三の支持シートを、プレス機を用いて、加圧しても、一對の加圧ローラを用いて、加圧してもよいが、一對の加圧ローラによって、第二の支持シートと第三の支持シートを加圧することが好ましい。

次いで、セラミックグリーンシートと、電極層およびスペーサ層とが、接着層を介して、接着される。

セラミックグリーンシートと、電極層およびスペーサ層は、接着層を介して、約 40°C ないし約 100°C の温度下で、約 $0.2\ \text{MPa}$ ないし約 $15\ \text{MPa}$ の圧力で、好ましくは、約 $0.2\ \text{MPa}$ ないし約 6

MP a の圧力で、加圧されて、セラミックグリーンシートと、スペーサ層および電極層が、接着層を介して、接着される。

- 好ましくは、一対の加圧ローラを用いて、セラミックグリーンシートと、接着層、電極層およびスペーサ層とが加圧されて、セラミック
- 5 グリーンシートと、電極層およびスペーサ層が、接着層を介して、接着される。

セラミックグリーンシートと、電極層およびスペーサ層とが、接着層を介して、接着されると、第一の支持シートが、セラミックグリーンシートから剥離される。

- 10 こうして得られた積層体が、所定のサイズに、裁断されて、第二の支持シート上に、剥離層、電極層、スペーサ層、接着層およびセラミックグリーンシートが積層された積層体ユニットが作製される。

以上のようにして、作製された多数の積層体ユニットが、接着層を介して、積層されて、積層体ブロックが作製される。

- 15 多数の積層体ユニットの積層にあたっては、まず、複数の孔が形成された基板上に、粘着層が形成された支持体がセットされる。

本発明において、支持体の材料は、とくに限定されるものではないが、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポリフェニレンエーテル、ポリエチレンテレフタレートなどのプラスチック材料

- 20 によって、形成されていることが好ましい。

支持体の厚さは、積層体ユニットを支持可能な厚さであれば、とくに限定されるものではない。

支持体は、基板上に形成された複数の孔を介して、エアによって吸引され、基板上の所定の位置に固定される。

- 25 粘着層は、支持体上に、粘着剤溶液が塗布されて、形成される。

本発明において、粘着剤溶液は、バインダと、任意成分として、可塑剤、剥離剤および帯電防止剤を含んでいる。

- 粘着剤溶液は、セラミックグリーンシートに含まれている誘電体粒子と同一組成の誘電体粒子を含んでもよい。粘着剤溶液が、誘電
- 30 体粒子を含んでいる場合には、誘電体粒子のバインダ重量に対する割

合が、セラミックグリーンシートに含まれている誘電体粒子のバインダ重量に対する割合より小さいことが好ましい。

粘着剤溶液に含まれるバインダは、セラミックグリーンシートを形成するための誘電体ペーストに含まれるバインダと同系のバインダであることが好ましいが、セラミックグリーンシートを形成するための誘電体ペーストに含まれるバインダと同系のバインダでなくてもよい。

粘着剤溶液に含まれる可塑剤は、セラミックグリーンシートを形成するための誘電体ペーストに含まれる可塑剤と同系の可塑剤であることが好ましいが、セラミックグリーンシートを形成するための誘電体ペーストに含まれる可塑剤と同系の可塑剤でなくてもよい。

可塑剤の含有量は、バインダ 100 重量部に対して、約 0 重量部ないし約 200 重量部、好ましくは、約 20 重量部ないし約 200 重量部、さらに好ましくは、約 50 重量部ないし約 100 重量部である。

本発明において、好ましくは、粘着剤溶液は、バインダの 0.01 重量%ないし 15 重量%の帯電防止剤を含み、さらに好ましくは、バインダの 0.01 重量%ないし 10 重量%の帯電防止剤を含んでいる。

本発明において、粘着剤溶液に含まれる帯電防止剤は、吸湿性を有する有機溶剤であればよく、たとえば、エチレングリコール；ポリエチレングリコール；2-3ブタンジオール；グリセリン；イミダゾリン系界面活性剤、ポリアルキレングリコール誘導体系界面活性剤、カルボン酸アミジン塩系界面活性剤などの両性界面活性剤などが、粘着剤溶液に含まれる帯電防止剤として使用することができる。

これらの帯電防止剤の中では、少量で、静電気を防止することが可能であるとともに、小さい剥離力で、粘着層から、第三の支持シートを剥離することが可能であるため、イミダゾリン系界面活性剤、ポリアルキレングリコール誘導体系界面活性剤、カルボン酸アミジン塩系界面活性剤などの両性界面活性剤が好ましくイミダゾリン系界面活性剤は、とくに小さな剥離力で、粘着層から、第三の支持シートを剥離することができるため、とくに好ましい。

本発明において、粘着層は、粘着層と支持体との間の接着強度が、

積層体ユニットの第二の支持シートと剥離層との間の接着強度よりも強く、かつ、粘着層と積層体ユニットのセラミックグリーンシートとの間の接着強度よりも弱くなるように、支持体上に形成される。

本発明において、好ましくは、積層体ユニットの第二の支持シート
5 と剥離層との間の接着強度が、5 ないし 20 mN/cm になるように、
第二の支持シートの表面に、剥離層が形成され、粘着層と支持体との
間の接着強度が、20 ないし 350 mN/cm で、かつ、粘着層と積
層体ユニットのセラミックグリーンシートとの間の接着強度が、35
0 mN/cm 以上になるように、支持体の表面に、粘着層が形成され
10 る。

本発明において、好ましくは、粘着層は、0.01 μ m ないし 0.
3 μ m の厚さで、支持体上に形成される。粘着層の厚さが、0.01
 μ m 未満の場合には、支持体と、積層体ユニットのセラミックグリー
ンシートとの間の接着強度が小さくなりすぎて、積層体ユニットを積
15 層することが困難になる。他方、粘着層の厚さが、0.3 μ m を越え
ると、積層体ユニットを積層して、セラミックグリーンチップを生成
し、セラミックグリーンチップを焼成したときに、粘着層の部分に間
隙が生成され、積層セラミック電子部品の静電容量が低下するので好
ましくない。

20 粘着層は、たとえば、室温 (25℃) ないし約 80℃ の温度で、約
1 分ないし約 5 分にわたって、乾燥される。粘着層の乾燥条件は、と
くに限定されるものではない。

積層体ユニットの積層に際しては、支持体の表面に形成された粘着
層の表面に、積層体ユニットのセラミックグリーンシートの表面を接
25 触させ、加圧して、支持体の表面に形成された粘着層に、積層体ユニ
ットを接着させる。

支持体の表面に形成された粘着層に、積層体ユニットが接着されて、
積層されると、積層体ユニットの剥離層から、第二の支持シートが剥
離される。

30 ここに、粘着層は、粘着層と支持体との間の接着強度が、積層体ユ

ニットの第二の支持シートと剥離層との間の接着強度よりも強く、かつ、粘着層と積層体ユニットのセラミックグリーンシートとの間の接着強度よりも弱くなるように、支持体上に形成されているから、第二の支持シートのみを容易に剥離することが可能になる。

- 5 支持体の表面に積層された積層体ユニットから、第二の支持シートが剥離されると、支持体の粘着層上に積層された積層体ユニット上に、さらに、新たな積層体ユニットが積層される。

- 支持体の粘着層上に積層された積層体ユニット上に、さらに、新たな積層体ユニットを積層するにあたっては、第三の支持シート上に形成された接着層を、電極層の表面に転写したのと同様に、まず、
10 第三の支持シート上に、接着層が形成され、積層すべき積層体ユニットのセラミックグリーンシートの表面に、接着層が転写される。

- 次いで、セラミックグリーンシートの表面に転写された接着層の表面が、支持体の粘着層に積層された積層体ユニットの剥離層の表面に
15 接触するように、新たに積層すべき積層体ユニットが位置決めされて、加圧され、支持体の粘着層に積層された積層体ユニット上に、新たな積層体ユニットが積層される。

次いで、新たに積層された積層体ユニットの第二の支持シートが剥離層から剥離される。

- 20 同様に、所定の数の積層体ユニットが、支持体の粘着層上に積層されて、積層体ブロックが作製される。

積層セラミック電子部品に含まれるべき所定の数の積層体ブロックが作製されると、積層セラミックコンデンサの外層などの基板上に、積層体ブロックが積層される。

- 25 まず、積層セラミックコンデンサなどの外層上に形成された接着層の表面に、積層体ブロックに最後に積層された積層体ユニットの剥離層の表面が接触するように、支持体上に積層された積層体ブロックを位置決めし、加圧して、積層体ブロックを、積層セラミックコンデンサの外層などの基板上に、積層体ブロックを積層する。

- 30 積層セラミックコンデンサの外層などの基板上に、積層体ブロック

が積層されると、積層体ブロックから、支持体が剥離される。

ここに、粘着層は、粘着層と支持体との間の接着強度が、積層体ユニットの第二の支持シートと剥離層との間の接着強度よりも強く、かつ、粘着層と積層体ユニットのセラミックグリーンシートと粘着層との間の接着強度よりも弱くなるように、支持体上に形成されているから、積層体ブロックから、支持体のみを容易に剥離することが可能になる。

積層セラミックコンデンサの外層などの基板上に積層された積層体ブロックから、支持体が剥離されると、積層セラミックコンデンサの外層などの基板上に積層された積層体ブロック上に、さらに、支持体上に積層された新たな積層体ブロックが積層される。

ここに、積層体ブロックから、支持体を剥離する際、支持体のみが剥離され、粘着層が積層体ブロック側に残っているから、積層セラミックコンデンサの外層などの基板上に積層された積層体ブロック上に、支持体上に積層された積層体ブロックを積層するにあたって、接着層を形成する必要がなく、したがって、効率的に、積層体ブロックを積層することが可能になる。

新たな積層体ブロックを積層するにあたっては、積層セラミックコンデンサの外層などの基板上に積層された積層体ブロックの粘着層の表面に、積層体ブロックに最後に積層された積層体ユニットの剥離層の表面が接触するように、支持体上に積層された新たな積層体ブロックを位置決めし、加圧して、新たな積層体ブロックを、積層セラミックコンデンサの外層などの基板上に積層された積層体ブロック上に、積層する。

同様にして、積層体ブロックが積層され、積層セラミック電子部品に含まれるべき所定の数の積層体ユニットが積層される。

本発明の上記およびその他の目的や特徴は、以下の記述および対応する図面から明らかになるであろう。

第1図は、第一の支持シートの表面上に、セラミックグリーンシートが形成された状態を示す略一部断面図である。

第2図は、その表面上に、剥離層および電極層が形成された第二の支持シートの略一部断面図である。

- 5 第3図は、剥離層の表面上に、電極層およびスペーサ層が形成された状態を示す略一部断面図である。

第4図は、第三の支持シートの表面上に、接着層が形成された接着層シートの略一部断面図である。

- 10 第5図は、第三の支持シート上に形成された接着層を、第二の支持シート上に形成された電極層およびスペーサ層の表面に接着させ、接着層から第三の支持シートを剥離する接着・剥離装置の好ましい実施態様を示す略断面図である。

- 15 第6図は、セラミックグリーンシートの表面に、接着層を介して、電極層およびスペーサ層を接着する接着装置の好ましい実施態様を示す略断面図である。

第7図は、第二の支持シート上に、電極層、スペーサ層、接着層およびセラミックグリーンシートが積層された積層体ユニットの略断面図である。

- 20 第8図は、積層体ユニットの積層プロセスの第一のステップを示す略一部断面図である。

第9図は、積層体ユニットの積層プロセスの第二のステップを示す略一部断面図である。

第10図は、積層体ユニットの積層プロセスの第三のステップを示す略一部断面図である。

- 25 第11図は、積層体ユニットの積層プロセスの第四のステップを示す略一部断面図である。

第12図は、積層体ユニットの積層プロセスの第五のステップを示す略一部断面図である。

- 30 第13図は、基板に固定されている支持体上に積層された積層体ブロックを、積層セラミックコンデンサの外層上に積層する積層プロセ

スの第一のステップを示す略一部断面図である。

第14図は、基板に固定されている支持体上に積層された積層体ブロックを、積層セラミックコンデンサの外層上に積層する積層プロセスの第二のステップを示す略一部断面図である。

5 第15図は、基板に固定されている支持体上に積層された積層体ブロックを、積層セラミックコンデンサの外層上に積層する積層プロセスの第三のステップを示す略一部断面図である。

第16図は、基板に固定されている支持体上に積層された積層体ブロックを、積層セラミックコンデンサの外層上に積層する積層プロセスの第四のステップを示す略一部断面図である。

10

発明の好ましい実施態様の説明

以下、添付図面に基づいて、本発明の好ましい実施態様である積層セラミックコンデンサの製造方法につき、詳細に説明を加える。

15 積層セラミックコンデンサを製造するにあたっては、まず、セラミックグリーンシートを製造するために、誘電体ペーストが調製される。

誘電体ペーストは、通常、誘電体原料と、有機溶剤中にバインダを溶解させた有機ビヒクルを混練して、調製される。

調製された誘電体ペーストは、たとえば、エクストルージョンコーターやワイヤーバーコーターなどを用いて、第一の支持シート上に塗布され、塗膜が形成される。

20

第一の支持シートとしては、たとえば、ポリエチレンテレフタレートフィルムなどが用いられ、剥離性を改善するために、その表面に、シリコン樹脂、アルキド樹脂などがコーティングされる。第一の支持シートの厚さは、とくに限定されるものではないが、好ましくは、約5 μm ないし約100 μm である。

25

次いで、塗膜が、たとえば、約50℃ないし約100℃の温度で、約1分ないし約20分にわたって、乾燥され、第一の支持シート上に、セラミックグリーンシートが形成される。

30 乾燥後におけるセラミックグリーンシート2の厚さは3 μm 以下で

あることが好ましく、さらに好ましくは、 $1.5\mu\text{m}$ 以下である。

第1図は、第一の支持シートの表面上に、セラミックグリーンシートが形成された状態を示す略一部断面図である。

実際には、第一の支持シート1は、長尺状をなし、セラミックグリーンシート2は、長尺状の第一の支持シート1の表面に、連続的に形成される。

一方、セラミックグリーンシート2とは別に、第二の支持シートが用意されて、第二の支持シート上に、剥離層および電極層が形成される。

10 第2図は、その表面上に、剥離層5および電極層6が形成された第二の支持シート4の略一部断面図である。

実際には、第二の支持シート4は、長尺状をなし、剥離層5は、長尺状の第二の支持シート4の表面に、連続的に形成され、剥離層5の表面に、電極層6が、所定のパターンで形成される。

15 第二の支持シート4の表面に、剥離層5を形成するにあたっては、まず、セラミックグリーンシート2を形成する場合と同様にして、剥離層5を形成するための誘電体ペーストが調製される。

剥離層5を形成するための誘電体ペーストは、好ましくは、セラミックグリーンシート2に含まれている誘電体と同一組成の誘電体の粒子を含んでいる。

剥離層5を形成するための誘電体ペーストに含まれているバインダは、セラミックグリーンシート2に含まれているバインダと同系であっても、同系でなくてもよいが、同系であることが好ましい。

25 こうして、誘電体ペーストが調製されると、たとえば、ワイヤーバーコーター（図示せず）を用いて、第二の支持シート4上に、誘電体ペーストが塗布され、剥離層5が形成される。

剥離層5の厚さは、電極層6の厚さ以下であることが好ましく、好ましくは、電極層6の厚さの約60%以下、さらに好ましくは、電極層6の厚さの約30%以下である。

30 第二の支持シート4としては、たとえば、ポリエチレンテレフタレ

ートフィルムなどが用いられ、剥離性を改善するために、その表面に、シリコン樹脂、アルキド樹脂などがコーティングされる。第二の支持シート4の厚さは、とくに限定されるものではなく、第一の支持シート1の厚さと同じであっても、異なってもよいが、好ましくは、

5 約 $5\mu\text{m}$ ないし約 $100\mu\text{m}$ である。

剥離層5の形成後、剥離層5は、たとえば、約 50°C ないし約 100°C で、約1分ないし約10分にわたって、乾燥される。

本実施態様においては、第二の支持シート4と剥離層5との間の接着強度が、 5 ないし $20\text{mN}/\text{cm}$ になるように、第二の支持シート
10 4の表面に、剥離層5が形成される。

剥離層5が乾燥された後、剥離層5の表面上に、焼成後に、内部電極層を構成する電極層6が、所定のパターンで形成される。

電極層6は、約 $0.1\mu\text{m}$ ないし約 $5\mu\text{m}$ の厚さに形成されることが好ましく、より好ましくは、約 $0.1\mu\text{m}$ ないし約 $1.5\mu\text{m}$ であ
15 る。

電極層6を、剥離層5上に形成するに際しては、まず、各種導電性金属や合金からなる導電体材料、焼成後に、各種導電性金属や合金からなる導電体材料となる各種酸化物、有機金属化合物、または、レジネートなどと、有機溶剤中にバインダを溶解させた有機ビビクルとを
20 混練して、電極ペーストが調製される。

電極ペーストを製造する際に用いる導電体材料としては、Ni、Ni合金あるいはこれらの混合物が、好ましく用いられる。

導電体材料の平均粒子径は、とくに限定されるものではないが、通常、約 $0.1\mu\text{m}$ ないし約 $2\mu\text{m}$ 、好ましくは、約 $0.2\mu\text{m}$ ないし
25 約 $1\mu\text{m}$ の導電性材料が用いられる。

電極層6は、スクリーン印刷機やグラビア印刷機などの印刷機を用いて、電極ペーストを、剥離層5上に印刷することによって形成される。

剥離層5の表面上に、所定パターンの有する電極層6を、スクリーン印刷法やグラビア印刷法によって、形成した後に、電極層6が形成
30

されていない剥離層 5 の表面に、電極層 6 と相補的なパターンで、スペーサ層が形成される。

第 3 図は、剥離層 5 の表面上に、電極層 6 およびスペーサ層 7 が形成された状態を示す略一部断面図である。

- 5 スペーサ層 7 は、剥離層 5 の表面に、電極層 6 を形成するのに先立って、電極層 6 が形成されるべき部分を除く剥離層 5 の表面に形成することもできる。

- 10 スペーサ層 7 を形成するにあたっては、セラミックグリーンシート 2 を作製したときに用いた誘電体ペーストと同様な組成の誘電体ペーストが調製され、スクリーン印刷法やグラビア印刷法により、誘電体ペーストが、電極層 6 が形成されていない剥離層 5 の表面に、電極層 6 と相補的なパターンで、印刷される。

- 15 本実施態様においては、スペーサ層 7 は、 $t_s / t_e = 1.1$ になるように、剥離層 5 上に形成される。ここに、 t_s はスペーサ層 7 の厚さであり、 t_e は電極層 6 の厚さである。

- 20 本実施態様においては、セラミックグリーンシート 2 と、電極層 6 およびスペーサ層 7 は、接着層を介して、接着されるように構成されており、セラミックグリーンシート 2 が形成された第一の支持シート 1 ならびに電極層 6 およびスペーサ層 7 が形成された第二の支持シート 4 とは別に、さらに、第三の支持シートが用意され、第三の支持シート上に、接着層が形成されて、接着層シートが作製される。

第 4 図は、第三の支持シート 9 の表面上に、接着層 10 が形成された接着層シート 11 の略一部断面図である。

- 25 実際には、第三の支持シート 9 は、長尺状をなし、接着層 10 は、長尺状の第三の支持シート 9 の表面に、連続的に形成される。

- 30 第三の支持シート 9 としては、たとえば、ポリエチレンテレフタレートフィルムなどが用いられ、剥離性を改善するために、その表面に、シリコン樹脂、アルキド樹脂などがコーティングされる。第三の支持シート 9 の厚さは、とくに限定されるものではないが、好ましくは、約 $5 \mu\text{m}$ ないし約 $100 \mu\text{m}$ である。

接着層 10 を形成するにあたっては、まず、接着剤溶液が調製される。

本実施態様においては、接着剤溶液は、バインダ、可塑剤および帯電防止剤と、任意成分として、剥離剤とを含んでいる。

- 5 接着剤溶液は、セラミックグリーンシートに含まれている誘電体粒子と同一組成の誘電体粒子を含んでいてもよい。接着剤溶液が、誘電体粒子を含んでいる場合には、誘電体粒子のバインダ重量に対する割合が、セラミックグリーンシートに含まれている誘電体粒子のバインダ重量に対する割合より小さいことが好ましい。
- 10 接着剤溶液に含まれるバインダは、セラミックグリーンシートを形成するための誘電体ペーストに含まれるバインダと同系のバインダであることが好ましいが、セラミックグリーンシートを形成するための誘電体ペーストに含まれるバインダと同系でないバインダであってもよい。
- 15 接着剤溶液に含まれる可塑剤は、セラミックグリーンシートを形成するための誘電体ペーストに含まれる可塑剤と同系の可塑剤であることが好ましいが、セラミックグリーンシートを形成するための誘電体ペーストに含まれるバインダと同系でない可塑剤であってもよい。
- 20 可塑剤の含有量は、バインダ 100 重量部に対して、約 0 重量部ないし約 200 重量部、好ましくは、約 20 重量部ないし約 200 重量部、さらに好ましくは、約 50 重量部ないし約 100 重量部である。
- 本実施態様において、接着剤溶液は、バインダの 0.01 重量%ないし 15 重量%の帯電防止剤を含んでいる。
- 本実施態様においては、帯電防止剤として、イミダゾリン系界面活性剤が用いられている。
- 25 こうして調製された接着剤溶液は、たとえば、バーコータ、エクストルージョンコータ、リバースコータ、ディップコーター、キスコーターなどによって、第三の支持シート 9 上に塗布され、好ましくは、約 0.02 μm ないし約 0.3 μm 、より好ましくは、約 0.02 μm ないし約 0.1 μm の厚さの接着層 10 が形成される。接着層 10
- 30

の厚さが、約 $0.02\ \mu\text{m}$ 未満の場合には、接着力が低下し、一方、接着層 10 の厚さが、約 $0.3\ \mu\text{m}$ を越えると、欠陥（隙間）の発生原因となり、好ましくない。

接着層 10 は、たとえば、室温（ 25°C ）ないし約 80°C の温度で、
5 約 1 分ないし約 5 分にわたって、乾燥される。接着層 10 の乾燥条件は、とくに限定されるものではない。

第 5 図は、第三の支持シート 9 上に形成された接着層 10 を、第二の支持シート 4 上に形成された電極層 6 およびスペーサ層 7 の表面に接着させ、接着層 10 から第三の支持シート 9 を剥離する接着・剥離
10 装置の好ましい実施態様を示す略断面図である。

第 5 図に示されるように、本実施態様にかかる接着・剥離装置は、約 40°C ないし約 100°C の温度に保持された一対の加圧ローラ 15、16 を備えている。

第 5 図に示されるように、接着層 10 が形成された第三の支持シート 9 は、第三の支持シート 9 に加えられる引張り力によって、第三の支持シート 9 が、上方の加圧ローラ 15 に巻回されるように、斜め上方から、一対の加圧ローラ 15、16 間に供給され、電極層 6 およびスペーサ層 7 が形成された第二の支持シート 4 は、第二の支持シート 4 が、下方の加圧ローラ 16 に接触し、電極層 6 およびスペーサ層 7
20 が、第三の支持シート 9 上に形成された接着層 10 の表面に接触するように、略水平方向に、一対の加圧ローラ 15、16 間に供給される。

第二の支持シート 4 および第三の支持シート 9 の供給速度は、たとえば、 $2\ \text{m}/\text{秒}$ に設定され、一対の加圧ローラ 15、16 のニップ圧力は、好ましくは、約 0.2 ないし約 $15\ \text{MPa}$ 、より好ましくは、
25 約 $0.2\ \text{MPa}$ ないし約 $6\ \text{MPa}$ に設定される。

その結果、第三の支持シート 9 上に形成された接着層 10 が、第二の支持シート 4 上に形成された電極層 6 およびスペーサ層 7 の表面に接着される。

第 5 図に示されるように、接着層 10 が形成された第三の支持シート 9 は、一対の加圧ローラ 15、16 の間から、斜め上方に向けて、
30

搬送され、したがって、第三の支持シート 9 が、電極層 6 およびスペーサ層 7 に接着した接着層 10 から剥離される。

- 接着層 10 から、第三の支持シート 9 を剥離する際、静電気が発生し、塵埃が付着したり、接着層が、第三の支持シートに引き付けられ、
- 5 所望のように、第三の支持シートを、接着層から剥離することが困難になることがあるが、本実施態様においては、接着層 10 が、バインダに対して、0.01 重量%ないし 15 重量%のイミダゾリン系界面活性剤を含んでいるから、静電気の発生を効果的に防止することが可能になる。

- 10 こうして、第二の支持シート 4 上に形成された電極層 6 およびスペーサ層 7 の表面に、接着層 10 が接着され、接着層 10 から、第三の支持シート 9 が剥離されると、電極層 6 およびスペーサ層 7 が、接着層 10 を介して、第一の支持シート 1 上に形成されたセラミックグリーンシート 2 の表面に接着される。

- 15 第 6 図は、セラミックグリーンシート 2 の表面に、接着層 10 を介して、電極層 6 およびスペーサ層 7 を接着する接着装置の好ましい実施態様を示す略断面図である。

- 第 6 図に示されるように、本実施態様にかかる接着装置は、約 40℃ないし約 100℃の温度に保持された一对の加圧ローラ 17、18 を
- 20 備え、電極層 6、スペーサ層 7 および接着層 10 が形成された第二の支持シート 4 は、第二の支持シート 4 が上方の加圧ローラ 17 に接触するように、一对の加圧ローラ 17、18 間に供給され、セラミックグリーンシート 2 が形成された第一の支持シート 1 は、第一の支持シート 1 が下方の加圧ローラ 18 に接触するように、一对の加圧ローラ
- 25 17、18 間に供給される。

本実施態様においては、加圧ローラ 17 は金属ローラによって構成され、加圧ローラ 18 はゴムローラによって構成されている。

- 第一の支持シート 1 および第二の支持シート 4 の供給速度は、たとえば、2 m/秒に設定され、一对の加圧ローラ 17、18 にニップ圧
- 30 力は、好ましくは、約 0.2 ないし約 15 MPa、より好ましくは、

約 0.2 MPa ないし約 6 MPa に設定される。

本実施態様においては、セラミックグリーンシート 2 と、電極層 6 およびスペーサ層 7 とは、接着層 10 を介して、接着され、従来のように、セラミックグリーンシート 2、電極層 6 およびスペーサ層 7 に含まれているバインダの粘着力や、セラミックグリーンシート 2、電極層 6 およびスペーサ層 7 の変形を利用して、セラミックグリーンシート 2 と、電極層 6 およびスペーサ層 7 とを接着してはいないから、たとえば、約 0.2 MPa ないし約 1.5 MPa の低い圧力で、セラミックグリーンシート 2 と、電極層 6 およびスペーサ層 7 とを接着することができる。

したがって、セラミックグリーンシート 2、電極層 6 およびスペーサ層 7 の変形を防止することが可能になるから、こうして得られたセラミックグリーンシート 2、電極層 6 およびスペーサ層 7 の積層体を積層して、積層セラミックコンデンサを作製する際の積層精度を向上させることが可能になる。

また、本実施態様においては、電極層 6 および電極層 6 よりも密度が小さく、圧縮率が高いスペーサ層 7 が、 $t_s / t_e = 1.1$ となるように形成されているから、電極層 6 およびスペーサ層 7 を、接着層 10 を介して、セラミックグリーンシート 2 上に転写する際に、加圧によって、スペーサ層 7 が圧縮され、接着層 10 を介して、電極層 6 およびスペーサ層 7 と、セラミックグリーンシート 2 とを確実に接着させることができ、したがって、第二の支持シート 4 を剥離するときに、電極層 6 が、第二の支持シート 4 とともに、剥離することを確実に防止することが可能になる。

さらに、本実施態様においては、第二の支持シート 4 上に、形成された電極層 6 が乾燥した後に、接着層 10 を介して、セラミックグリーンシート 2 の表面に接着するように構成されているから、セラミックグリーンシート 2 の表面に、電極ペーストを印刷して、電極層 6 を形成する場合のように、電極ペーストが、セラミックグリーンシート 2 に含まれているバインダを溶解させ、あるいは、膨潤させることが

なく、また、電極ペーストがセラミックグリーンシート2中に染み込むこともなく、所望のように、セラミックグリーンシート2の表面に、電極層6を形成することが可能になる。

5 以上のようにして、第二の支持シート4上に形成された電極層6およびスペーサ層7の表面に、接着層10を介して、第一の支持シート1上に形成されたセラミックグリーンシート2が接着されると、セラミックグリーンシート2から、第一の支持シート1が剥離される。

10 こうして、第二の支持シート4の表面上に、剥離層5、電極層6、スペーサ層7、接着層10およびセラミックグリーンシート2が積層された積層体が形成される。

以上のようにして得られた積層体が、所定のサイズに裁断されて、第二の支持シート4の表面上に、剥離層5、電極層6、スペーサ層7、接着層10およびセラミックグリーンシート2が積層された所定のサイズを有する積層体ユニットが作製される。

15 第7図は、こうして、所定のサイズに裁断された積層体ユニットの略断面図である。

第7図に示されるように、積層体ユニット20は、第二の支持シート4の表面上に形成され、剥離層5、電極層6、スペーサ層7、接着層10およびセラミックグリーンシート2を含んでいる。

20 同様にして、第二の支持シート4の表面上に、剥離層5、電極層6、スペーサ層7、接着層10およびセラミックグリーンシート2を積層して、それぞれが、剥離層5、電極層6、スペーサ層7、接着層10およびセラミックグリーンシート2を含む多数の積層体ユニット20が作製される。

25 こうして作製された多数の積層体ユニット20を、セラミックグリーンシート2の表面に転写された接着層を介して、積層することによって、積層セラミックコンデンサが作製される。

第8図は、積層体ユニット20の積層プロセスの第一のステップを示す略一部断面図である。

30 第8図に示されるように、積層体ユニット20の積層にあたっては、

まず、多数の孔 26 が形成された基板 25 上に、表面に、粘着層が 27 が形成された支持体 28 がセットされる。

支持体 28 としては、たとえば、ポリエチレンテレフタレートフィルムなどが用いられる。

- 5 本実施態様においては、粘着層 27 は、粘着層 27 と支持体 28 との間の接着強度が、積層体ユニット 20 の第二の支持シート 4 と剥離層 5 との間の接着強度よりも強く、かつ、粘着層 27 と積層体ユニット 20 のセラミックグリーンシート 2 との間の接着強度よりも弱くなるように、支持体 28 上に形成されている。
- 10 本実施態様においては、粘着層 27 と支持体 28 との間の接着強度が、20 ないし 350 mN/cm で、かつ、粘着層 27 と積層体ユニット 20 のセラミックグリーンシート 2 との間の接着強度が、350 mN/cm 以上になるように、支持体 28 の表面に、粘着層 27 が形成されている。
- 15 粘着層 27 は、支持体 28 上に、粘着剤溶液が塗布されて、形成される。
- 本実施態様において、粘着剤溶液は、バインダ、可塑剤および帯電防止剤と、任意成分として、剥離剤を含んでいる。
- 粘着剤溶液には、セラミックグリーンシートを形成するための誘電
- 20 体ペーストに含まれるバインダと同系のバインダが含まれ、また、セラミックグリーンシートを形成するための誘電体ペーストに含まれるバインダと同系の可塑剤が含まれている。
- 粘着剤溶液は、バインダの 0.01 重量% ないし 15 重量% のイミダゾリン系界面活性剤を含んでいる。
- 25 本実施態様において、粘着層 27 は、0.01 μ m ないし 0.3 μ m の厚さを有している。粘着層 27 の厚さが、0.01 μ m 未満の場合には、支持体 28 と、積層体ユニット 20 のセラミックグリーンシート 2 との間の接着強度が小さくなりすぎて、積層体ユニット 20 を積層することが困難になり、その一方で、粘着層 27 の厚さが、0.
- 30 3 μ m を越えると、積層体ユニット 20 を積層して、セラミックグリ

ーンチップを生成し、セラミックグリーンチップを焼成したときに、
粘着層 27 の部分に間隙が生成され、積層セラミック電子部品の静電
容量が低下し、好ましくない。

支持体 28 は、基板 25 に形成された多数の孔 26 を介して、エア
5 により吸引され、基板 25 上の所定の位置に固定される。

第 9 図は、積層体ユニット 20 の積層プロセスの第二のステップを
示す略一部断面図である。

次いで、第 9 図に示されるように、セラミックグリーンシート 2 の
表面が、支持体 28 上に形成された粘着層 27 の表面に接触するよう
10 に、積層体ユニット 20 が位置決めされて、積層体ユニット 20 の第
二の支持シート 4 上に、プレス機などによって、圧力が加えられる。

その結果、積層体ユニット 20 が、粘着層 27 を介して、基板 25
上に固定された支持体 28 上に接着されて、積層される。

第 10 図は、積層体ユニット 20 の積層プロセスの第三のステップ
15 を示す略一部断面図である。

積層体ユニット 20 が、粘着層 27 を介して、基板 25 上に固定さ
れた支持体 28 上に接着されて、積層されると、第 10 図に示される
ように、第二の支持シート 4 が、積層体ユニット 20 の剥離層 5 から
剥離される。

20 本実施態様においては、積層体ユニット 20 の第二の支持シート 4
と剥離層 5 との間の接着強度が、5 ないし 20 mN/cm になるよう
に、第二の支持シート 4 の表面に、剥離層 5 が形成され、粘着層 27
と支持体 28 との間の接着強度が、20 ないし 350 mN/cm で、
かつ、粘着層 27 と積層体ユニット 20 のセラミックグリーンシート
25 2 との間の接着強度が、350 mN/cm 以上になるように、支持体
28 の表面に、粘着層 27 が形成されており、粘着層 27 と支持体 2
8 との間の接着強度が、積層体ユニット 20 の第二の支持シート 4 と
剥離層 5 との間の接着強度よりも強く、かつ、粘着層 27 と積層体ユ
ニット 20 のセラミックグリーンシート 2 との間の接着強度よりも弱
30 くなるように、粘着層 27 が支持体 28 上に形成されているから、粘

着層 27 に接着された積層体ユニット 20 から、第二の支持シート 4 のみを容易に剥離することが可能になる。

また、本実施態様においては、電極層 6 およびスペーサ層 7 が、 $t_s / t_e = 1.1$ となるように形成されているので、一対の加圧ローラ 17、18 により、スペーサ層 7 が圧縮されて、スペーサ層 7 のみならず、電極層 6 も、接着層 10 を介して、セラミックグリーンシート 2 の表面に接着され、したがって、第二の支持シート 4 を剥離するときに、電極層 6 が、第二の支持シート 4 とともに、セラミックグリーンシート 2 から剥離することを効果的に防止することができる。

- 10 こうして、第二の支持シート 4 が、積層体ユニット 20 の剥離層 5 から剥離されると、粘着層 27 を介して、基板 25 上に固定されている支持体 28 上に積層された積層体ユニット 20 の剥離層 5 上に、さらに、新たな積層体ユニット 20 が積層される。

- 15 積層に先立って、まず、新たに積層されるべき積層体ユニット 20 のセラミックグリーンシート 2 の表面に、第三の支持シート 9 に形成された接着層 10 が転写される。

- 20 すなわち、第二の支持シート 4 上に形成された電極層 6 およびスペーサ層 7 の表面に、接着層シート 11 の接着層 10 を転写したのと全く同様に、接着層シート 11 の接着層 10 が、新たに積層されるべき積層体ユニット 20 のセラミックグリーンシート 2 の表面に転写される。

第 11 図は、積層体ユニット 20 の積層プロセスの第四のステップを示す略一部断面図である。

- 25 次いで、第 11 図に示されるように、セラミックグリーンシート 2 上に転写された接着層 10 の表面が、粘着層 27 に接着された積層体ユニット 20 の剥離層 5 の表面に接触するように、新たな積層体ユニット 20 が位置決めされて、プレス機などによって、加圧される。

- 30 その結果、新たな積層体ユニット 20 が、セラミックグリーンシート 2 上に転写された接着層 10 を介して、粘着層 27 に接着された積層体ユニット 20 上に積層される。

第12図は、積層体ユニット20の積層プロセスの第五のステップを示す略一部断面図である。

新たな積層体ユニット20が、セラミックグリーンシート2上に形成された接着層10を介して、粘着層27に接着された積層体ユニット20上に、積層されると、第12図に示されるように、新たに積層された積層体ユニット20の第二の支持シート4が、積層体ユニット20の剥離層5から剥離される。

本実施態様においては、積層体ユニット20の第二の支持シート4と剥離層5との間の接着強度が、5ないし20mN/cmになるように、第二の支持シート4の表面に、剥離層5が形成され、粘着層27と支持体28との間の接着強度が、20ないし350mN/cmで、かつ、粘着層27と積層体ユニット20のセラミックグリーンシート2との間の接着強度が、350mN/cm以上になるように、支持体28の表面に、粘着層27が形成されており、粘着層27と支持体28との間の接着強度が、積層体ユニット20の第二の支持シート4と剥離層5との間の接着強度よりも強く、かつ、粘着層27と積層体ユニット20のセラミックグリーンシート2との間の接着強度よりも弱くなるように、粘着層27が支持体28上に形成され、新たに積層された積層体ユニット20は、接着層10によって、粘着層27に接着された積層体ユニット20に接着されているから、粘着層27に接着された積層体ユニット20から、第二の支持シート4のみを容易に剥離することが可能になる。

同様にして、積層体ユニット20が、次々に積層されて、所定の数の積層体ユニット20が、基板25に固定された支持体28上に積層されて、積層体ブロックが作製される。

所定の数の積層体ユニット20が、基板25に固定された支持体28上に積層されて、積層体ブロックが作製されると、基板25に固定されている支持体28上に、所定の数の積層体ユニット20が積層されて、作製された積層体ブロックが、積層セラミックコンデンサの外層上に積層される。

第13図は、基板25に固定されている支持体28上に積層された積層体ブロックを、積層セラミックコンデンサの外層上に積層する積層プロセスの第一のステップを示す略一部断面図である。

第13図に示されるように、まず、多数の孔31が形成された基台30上に、接着層32が形成された外層33がセットされる。

外層33は、基台30に形成された多数の孔31を介して、エアにより吸引され、基台30上の所定の位置に固定される。

次いで、第13図に示されるように、多数の孔26を介して、エアにより吸引され、基板25上の所定の位置に固定されている支持体28上に積層された積層体ブロック40が、最後に積層された積層体ユニット20の剥離層5の表面が、外層33上に形成された接着層32の表面に接触するように、位置決めされる。

次いで、エアによる支持体28の吸引が停止されて、基板25が、積層体ブロック40を支持している支持体28から取り去られる。

基板25が、支持体28から取り去られると、プレス機などによって、支持体28が加圧される。

その結果、積層体ブロック40が、接着層32を介して、基台30上に固定された外層33上に接着されて、積層される。

第14図は、基板25に固定されている支持体28上に積層された積層体ブロック40を、積層セラミックコンデンサの外層33上に積層する積層プロセスの第二のステップを示す略一部断面図である。

積層体ブロック40が、接着層32を介して、基台30上に固定された外層33上に接着されて、積層されると、第14図に示されるように、支持体28が、積層体ブロック40の粘着層27から剥離される。

本実施態様においては、積層体ユニット20の第二の支持シート4と剥離層5との間の接着強度が、5ないし20mN/cmになるように、第二の支持シート4の表面に、剥離層5が形成され、粘着層27と支持体28との間の接着強度が、20ないし350mN/cmで、かつ、粘着層27と積層体ユニット20のセラミックグリーンシート

2との間の接着強度が、 350 mN/cm 以上になるように、支持体28の表面に、粘着層27が形成されており、粘着層27は、粘着層27と支持体28との間の接着強度が、積層体ユニット20の第二の支持シート4と剥離層5との間の接着強度よりも強く、かつ、粘着層527と積層体ユニット20のセラミックグリーンシート2との間の接着強度よりも弱くなるように、支持体28上に形成されているから、外層33上に積層された積層体ブロック40から、支持体28のみを容易に剥離することが可能になる。

10 こうして、接着層32を介して、基台30上に固定されている外層33上に、所定の数の積層体ユニット20が積層された積層体ブロック40が積層される。

15 さらに、第8図ないし第12図に示されたステップにしたがって、基板25に固定されている支持シート28上に、所定の数の積層体ユニット20が積層されて、積層体ブロック40が作製され、接着層32を介して、基台30上に固定されている外層33上に積層された積層ブロック40上に積層される。

第15図は、基板25に固定されている支持シート体28上に積層された積層体ブロック40を、積層セラミックコンデンサの外層上に積層する積層プロセスの第三のステップを示す略一部断面図である。

20 第15図に示されるように、多数の孔26を介して、エアにより吸引され、基板25上の所定の位置に固定されている支持体28上に新たに積層された積層体ブロック40が、最後に積層された積層体ユニット20の剥離層5の表面が、外層33上に積層された積層体ブロック40の粘着層27の表面に接触するように、位置決めされる。

25 次いで、エアによる支持体28の吸引が停止されて、基板25が、積層体ブロック40を支持している支持体28から取り去られる。

基板25が、支持体28から取り去られると、プレス機などによって、支持体28が加圧される。

30 本実施態様においては、外層33上に積層された積層体ブロック40の最上層は、支持体28から剥離されて、積層体ブロック40側に

残った粘着層 27 によって構成されているから、外層 33 上に積層された積層体ブロック 40 に、新たな積層体ブロック 40 を積層するにあたって、接着層を形成する必要がなく、したがって、効率的に、積層体ブロック 40 を積層することが可能になる。

- 5 その結果、新たに積層された積層体ブロック 40 が、粘着層 27 を介して、基台 30 上に固定されている外層 33 上に積層された積層体ブロック 40 に接着されて、積層される。

- 第 16 図は、基板 25 に固定されている支持体 28 上に積層された積層体ブロック 40 を、積層セラミックコンデンサの外層 33 上に積層する積層プロセスの第四のステップを示す略一部断面図である。
- 10

- 新たに積層された積層体ブロック 40 が、粘着層 27 を介して、基台 30 上に固定されている外層 33 上に積層された積層体ブロック 40 に接着されて、積層されると、第 16 図に示されるように、支持体 28 が、新たに積層された積層体ブロック 40 の粘着層 27 から剥離
- 15 される。

こうして、基台 30 上に固定されている外層 33 上に積層された積層体ブロック 40 上に、粘着層 27 を介して、新たに積層された積層体ブロック 40 が接着されて、積層される。

- 同様にして、基板 25 に固定されている支持体 28 上に積層された積層体ブロック 40 が、次々に積層されて、所定の数の積層体ブロック 40、したがって、所定の数の積層体ユニット 20 が、積層セラミックコンデンサの外層 33 上に積層される。
- 20

- こうして、積層セラミックコンデンサの外層 33 上に、所定の数の積層体ユニット 20 が積層されると、他方の外層（図示せず）が、接着層を介して、接着されて、所定の数の積層体ユニット 20 を含む積層体が作成される。
- 25

次いで、所定の数の積層体ユニット 20 を含む積層体が、所定のサイズに裁断されて、多数のセラミックグリーンチップが作製される。

- こうして作製されたセラミックグリーンチップは、還元ガス雰囲気
- 30 下に置かれて、バインダが除去され、さらに、焼成される。

次いで、焼成されたセラミックグリーンチップに、必要な外部電極などが取り付けられて、積層セラミックコンデンサが作製される。

本実施態様によれば、支持体 28 の表面に、粘着層 27 が形成され、第二の支持シート 4 上に、剥離層 5、電極層 6、スペーサ層 7、接着層 10 およびセラミックグリーンシート 2 が積層された積層体ユニット 20 は、基板 25 に固定された支持体 28 の表面に形成された粘着層 27 上に、積層体ユニット 20 のセラミックグリーンシート 2 の表面が、粘着層 27 に面接触するように、支持体上に積層され、粘着層 27 は、粘着層 27 と支持体 28 との間の接着強度が、積層体ユニット 20 の第二の支持シート 4 と剥離層 5 との間の接着強度よりも強く、かつ、粘着層 27 と積層体ユニット 20 のセラミックグリーンシート 2 との間の接着強度よりも弱くなるように、支持体 28 の表面に形成されているから、所望の数の積層体ユニット 20 を積層して、積層セラミック電子部品を製造する場合に、積層体ユニット 20 が損傷されることを効果的に防止することが可能になる。

また、本実施態様によれば、積層体ユニット 20 の第二の支持シート 4 と剥離層 5 との間の接着強度が、5 ないし 20 mN/cm になるように、第二の支持シート 4 の表面に、剥離層 5 が形成され、粘着層 27 と支持体 28 との間の接着強度が、20 ないし 350 mN/cm で、かつ、粘着層 27 と積層体ユニット 20 のセラミックグリーンシート 2 との間の接着強度が、350 mN/cm 以上になるように、支持体 28 の表面に、粘着層 27 が形成されており、粘着層 27 は、粘着層 27 と支持体 28 との間の接着強度が、積層体ユニット 20 の第二の支持シート 4 と剥離層 5 との間の接着強度よりも強く、かつ、粘着層 27 と積層体ユニット 20 のセラミックグリーンシート 2 との間の接着強度よりも弱くなるように、支持体 28 の表面に形成されているから、支持体 28 上の粘着層 27 の表面に、所定の枚数の積層体ユニット 20 を積層して、作製した積層体ブロック 40 を、積層セラミックコンデンサの外層 33 上に形成された接着層 32 に接着させて、積層した後、その上に、さらに、積層体ブロック 40 を積層するため、

- 外層 3 3 上に積層された積層体ブロック 4 0 から、支持体 2 8 を剥離するとき、支持体 2 8 のみが剥離され、粘着層 2 7 が、積層体ブロック 4 0 側に残るから、外層 3 3 上に積層された積層体ブロック 4 0 に、新たな積層体ブロック 4 0 を積層するにあたって、接着層を形成する必要がなく、したがって、効率的に、積層体ブロック 4 0 を積層することが可能になる。

以下、本発明の効果を、より一層明らかにするため、実施例および比較例を掲げる。

実施例 1

10 セラミックグリーンシート用の誘電体ペーストの調製

以下の組成を有する誘電体粉末を調製した。

	B a T i O ₃ 粉末 (堺化学工業株式会社製 : 商品名「B T - 0 2」)	1 0 0 重量部
	M g C O ₃	0 . 7 2 重量部
15	M n O	0 . 1 3 重量部
	(B a _{0.6} C a _{0.4}) S i O ₃	1 . 5 重量部
	Y ₂ O ₃	1 . 0 重量部

- こうして調製した誘電体粉末 1 0 0 重量部に対して、以下の組成を有する有機ビヒクルを加え、ボールミルを用いて、2 0 時間にわたって、混合し、セラミックグリーンシート用の誘電体ペーストを調製した。

	ポリビニルブチラール樹脂 (バインダ)	6 重量部
	フタル酸ビス (2 エチルヘキシル)	3 重量部
	(D O P : 可塑剤)	
25	エタノール	7 8 重量部
	n - プロパノール	7 8 重量部
	キシレン	1 4 重量部
	ミネラルスピリット	7 重量部
	分散剤	0 . 7 重量部

30 剥離層用の誘電体ペーストの調製

BaTiO₃粉末（堺化学工業株式会社製：商品名「BT-01」）を用いた以外は、セラミックグリーンシート用の誘電体ペーストを調製したのと、全く同様にして、誘電体ペーストを調製し、エタノールと、プロパノールと、キシレンの混合溶液（混合比42.5：42.5：15）によって、誘電体ペーストを希釈して、剥離層用の誘電体ペーストを調製した。

5 5：15）によって、誘電体ペーストを希釈して、剥離層用の誘電体ペーストを調製した。

接着剤ペーストの調製

以下の組成を有する有機ビヒクルを調製し、得られた有機ビヒクルを、メチルエチルケトンによって、10倍に希釈して、接着剤用のペーストを調製した。

ポリビニルブチラール樹脂（バインダ）	100重量部
フタル酸ビス（2エチルヘキシル）	50重量部
（DOP：可塑剤）	
メチルエチルケトン	900重量部

15 電極用のペーストの調製

100重量部の平均粒径が0.2μmのNi粒子に対して、以下の組成の溶液を加え、ボールミルによって、20時間にわたり、混合して、スラリーを得た。

BaTiO ₃ 粉末（堺化学工業株式会社製：商品名「BT-02」）	20重量部
有機ビヒクル	58重量部
フタル酸ビス（2エチルヘキシル）	50重量部
（DOP：可塑剤）	
ターピネオール	5重量部
分散剤	1重量部
アセトン	45重量部

ここに、有機ビヒクルは、8重量部のポリビニルブチラール樹脂を、92重量部のターピネオールに溶解して、調製した。

こうして得られたスラリーを、40℃で、加熱し、攪拌して、余剰のアセトンを揮発させ、電極層用のペーストを調製した。

スペーサ層用の誘電体ペーストの調製

セラミックグリーンシート用の誘電体ペーストを調製するのに用いた誘電体粉末 100 重量部に対して、以下の組成を有する溶液を加え、ボールミルを用いて、20 時間にわたり、混合して、スラリーを得た。

- | | | |
|----|--------------------|--------|
| 5 | 有機ビヒクル | 71 重量部 |
| | フタル酸ビス (2 エチルヘキシル) | 50 重量部 |
| | (DOP : 可塑剤) | |
| | ターピネオール | 5 重量部 |
| | 分散剤 | 1 重量部 |
| 10 | アセトン | 64 重量部 |

ここに、有機ビヒクルは、8 重量部のポリビニルブチラール樹脂を、92 重量部のターピネオールに溶解して、調製した。

こうして得られたスラリーを、40℃で、加熱し、攪拌して、余剰のアセトンを揮発させ、スペーサ層用のペーストを調製した。

15 セラミックグリーンシートの作製

ワイヤーバーコーターを用いて、第一のポリエチレンテレフタレートフィルムの上に、セラミックグリーンシート用の誘電体ペーストを塗布し、乾燥させ、1.5 μm の厚さのセラミックグリーンシートを作製した。

20 剥離層、電極層およびスペーサ層の形成

ワイヤーバーコーターを用いて、第二のポリエチレンテレフタレートフィルムの上に、剥離層用の誘電体ペーストを塗布し、乾燥させ、0.2 μm の厚さの剥離層を形成した。

- こうして形成された剥離層の表面に、スクリーン印刷法を用いて、
- 25 所定のパターンで、電極層用のペーストを印刷し、1.0 μm の厚さの電極層を形成した。

次いで、電極層が形成されていない剥離層の表面に、スクリーン印刷法を用いて、電極層と相補的なパターンで、スペーサ層用の誘電体ペーストを印刷して、1.0 μm の厚さのスペーサ層を形成した。

30 接着層の形成

ワイヤーバーコーターを用いて、第三のポリエチレンテレフタレートフィルムの上に、接着剤ペーストを塗布し、 $0.1\mu\text{m}$ の厚さの接着層を形成した。

接着層の転写

- 5 第5図に示された接着・剥離装置を用いて、電極層およびスペーサ層の表面に、第三のポリエチレンテレフタレートフィルムの上に形成された接着層を接着し、第三のポリエチレンテレフタレートフィルムを剥離して、電極層およびスペーサ層の表面に、接着層を転写した。

10 一对の加圧ローラのニップ圧力は、 1MPa で、温度は、 50°C であった。

電極層およびスペーサ層の表面へのセラミックグリーンシートの転写

第6図に示された接着装置を用いて、電極層およびスペーサ層の表面に転写された接着層を介して、電極層およびスペーサ層と、セラミックグリーンシートを接着した。

- 15 一对の加圧ローラのニップ圧力は、 5MPa で、温度は、 100°C であった。

次いで、セラミックグリーンシートから、第一のポリエチレンテレフタレートフィルムを剥離し、第二のポリエチレンテレフタレートフィルム上に、剥離層、電極層、スペーサ層、接着層およびセラミックグリーンシートが積層された積層体ユニットを得た。

支持体の準備

1. $5\text{重量}\%$ のポリビニルブチラールと、 $0.75\text{重量}\%$ のジオクチルフタレートを含むエタノール溶液を調製し、ポリエチレンテレフタレートフィルムによって形成されたシートの表面に塗布して、 $0.02\mu\text{m}$ の厚さの粘着層を形成した。

次いで、粘着層が形成されたシートを、 $60\text{mm}\times 70\text{mm}$ のサイズに裁断して、支持体を作製し、基板上に固定した。

積層体ユニットの積層

- 30 積層体ユニットのセラミックグリーンシートの表面が、支持体の表面に形成された粘着層の表面に接触するように、積層体ユニットを位

置決めし、50℃の温度下において、2MPaの圧力で、5秒間にわたり、加圧して、積層体ユニットを、支持体の表面に形成された粘着層に接着して、支持体上に積層した。

- 次いで、積層体ユニットの剥離層から、第二のポリエチレンテレフタレートフィルムを剥離した。

新たに積層すべき積層体ユニットの準備

- さらに、ワイヤーバーコーターを用いて、第三のポリエチレンテレフタレートフィルムの表面に、接着剤ペーストを塗布して、0.1μmの厚さの接着層を形成し、第5図に示された接着・剥離装置を用いて、新たに積層すべき積層体ユニットのセラミックグリーンシートの表面に、第三のポリエチレンテレフタレートフィルムの表面に形成された接着層を接着し、第三のポリエチレンテレフタレートフィルムを剥離して、新たに積層すべき積層体ユニットのセラミックグリーンシートの表面に、接着層を転写した。

15 積層体ブロックの作製

- さらに、新たな積層体ユニットのセラミックグリーンシート上に転写された接着層の表面が、支持体上に積層された積層体ユニットの剥離層の表面に接触するように位置決めして、50℃の温度下において、2MPaの圧力で、5秒間にわたり、加圧し、支持体上に積層された積層体ユニットに、新たな積層体ユニットを積層した。

積層後、新たに積層した積層体ユニットの剥離層から、第二のポリエチレンテレフタレートフィルムを剥離した。

同様にして、合計10の積層体ユニットを、支持体上に積層して、積層体ブロックを作製した。

- さらに、同様にして、それぞれが、10の積層体ユニットを含む5つの積層体ブロックを作製した。

セラミックグリーンチップの作製

- 積層セラミックコンデンサの蓋部分を形成する外層上に、約50μmの厚さの接着層を形成し、接着層の表面に、積層体ブロックのセラミックグリーンシートが接触するように、積層体ブロックを位置決め

し、50℃の温度下において、2MPaの圧力で、5秒間にわたり、加圧して、外層上に、積層体ブロックを積層した。

積層後、積層体ブロックから、支持体を剥離した。

さらに、外層上に積層された積層体ブロックの表面に、約50μmの厚さの接着層を形成し、外層上に積層された積層体ブロックの接着層の表面に、新たな積層体ブロックのセラミックグリーンシートが接触するように、新たな積層体ブロックを位置決めし、50℃の温度下において、2MPaの圧力で、5秒間にわたり、加圧して、外層上に積層された積層体ブロック上に、新たな積層体ブロックを積層した。

10 同様にして、外層上に、合計5つの積層体ブロックを積層し、最上に積層体ブロックの表面に、約50μmの厚さの接着層を形成し、接着層上に、積層セラミックコンデンサの蓋部分を形成する外層を接着して、積層体ブロック上に積層した。

こうして得られた50の積層体ユニットを含む積層体を、40℃の温度下において、100MPaの圧力で、30秒間にわたり、加圧して、プレス成形し、ダイシング加工機によって、所定のサイズに裁断し、セラミックグリーンチップを作製した。

積層セラミックコンデンサの作製

こうして作製されたセラミックグリーンチップを、窒素ガスの雰囲気下において、以下の条件で処理し、バインダを除去した。

昇温温度：50℃／時間

保持温度：400℃

保持時間：2時間

25 バインダを除去した後、セラミックグリーンチップを、露点20℃に制御された窒素ガスと水素ガスの混合ガスの雰囲気下において、以下の条件で処理し、焼成した。

昇温温度：300℃／時間

保持温度：1240℃

保持時間：3時間

30 冷却速度：300℃／時間

さらに、焼成したセラミックグリーンチップに、露点 20℃に制御された窒素ガスの雰囲気下において、以下の条件で、アニール処理を施した。

保持時間：2 時間

- 5 冷却速度：300℃/時間

こうして得られた焼結体に、端面研磨を施した後、露点 20℃に制御された窒素ガスと水素ガスの混合ガスの雰囲気下において、以下の条件で、端子電極用ペーストを焼き付けて、端子電極を形成した。

昇温速度：500℃/時間

- 10 保持温度：700℃

保持時間：10 分

冷却速度：500℃/時間

さらに、端子電極上に、めっきを施して、積層セラミックコンデンサを作成した。

- 15 以上のようにして得られた積層セラミックコンデンサのサンプルは、セラミックグリーンシートの積層数が 50 層であり、サイズは、長さが 1.6 mm で、幅が 0.8 mm であった。

全く同様にして、合計 20 個の積層セラミックコンデンサのサンプルを作製した。

- 20 特性試験

これら 20 個の積層セラミックコンデンサのサンプルについて、横河・ヒューレット・パカード株式会社製デジタル LCR メータ「4274A」(商品名)を用いて、静電容量を測定した。測定は、基準温度 25℃、周波数 120 Hz、入力信号レベル(測定電圧) 0.5 V r m s の条件下でおこなった。

- 25 次いで、こうして作製した積層セラミックコンデンサのサンプルの静電容量の理論値(理論静電容量)を算出し、20 個の積層セラミックコンデンサのサンプルの測定した静電容量の平均値(測定静電容量)と理論静電容量とを比較して、理論静電容量に対する測定静電容量の
30 減少率(%)を算出したところ、10%を越えていたが、20%以下

であった。

ここに、理論静電容量は、セラミックグリーンシートの縮率が 0.67 であるとして、算出した。

実施例 2

- 5 厚さ 0.1 μm の粘着層を、支持体の表面に形成した以外は、実施例 1 と同様にして、20 個の積層セラミックコンデンサのサンプルを作製し、それぞれの静電容量を測定した。

10 こうして測定した積層セラミックコンデンサの各サンプルの静電容量の平均値（測定静電容量）と理論静電容量と比較して、理論静電容量に対する測定静電容量の減少率（%）を算出したところ、10%以下であった。

実施例 3

- 15 厚さ 0.2 μm の粘着層を、支持体の表面に形成した以外は、実施例 1 と同様にして、20 個の積層セラミックコンデンサのサンプルを作製し、それぞれの静電容量を測定した。

こうして測定した積層セラミックコンデンサの各サンプルの静電容量の平均値（測定静電容量）と理論静電容量と比較して、理論静電容量に対する測定静電容量の減少率（%）を算出したところ、10%以下であった。

20 実施例 4

厚さ 0.3 μm の粘着層を、支持体の表面に形成した以外は、実施例 1 と同様にして、20 個の積層セラミックコンデンサのサンプルを作製し、それぞれの静電容量を測定した。

- 25 こうして測定した積層セラミックコンデンサの各サンプルの静電容量の平均値（測定静電容量）と理論静電容量と比較して、理論静電容量に対する測定静電容量の減少率（%）を算出したところ、10%を越えていたが、20%以下であった。

実施例 5

- 30 厚さ 0.01 μm の粘着層を、支持体の表面に形成した以外は、実施例 1 と同様にして、20 個の積層セラミックコンデンサのサンプル

を作製し、それぞれの静電容量を測定した。

- こうして測定した積層セラミックコンデンサの各サンプルの静電容量の平均値（測定静電容量）と理論静電容量と比較して、理論静電容量に対する測定静電容量の減少率（％）を算出したところ、10％を
- 5 越えていたが、20％以下であった。

比較例 1

厚さ0.5 μm の粘着層を、支持体の表面に形成した以外は、実施例1と同様にして、20個の積層セラミックコンデンサのサンプルを作製し、それぞれの静電容量を測定した。

- 10 こうして測定した積層セラミックコンデンサの各サンプルの静電容量の平均値（測定静電容量）と理論静電容量と比較して、理論静電容量に対する測定静電容量の減少率（％）を算出したところ、20％を越えていた。

比較例 2

- 15 厚さ1.0 μm の粘着層を、支持体の表面に形成した以外は、実施例1と同様にして、20個の積層セラミックコンデンサのサンプルを作製し、それぞれの静電容量を測定した。

- こうして測定した積層セラミックコンデンサの各サンプルの静電容量の平均値（測定静電容量）と理論静電容量と比較して、理論静電容量に対する測定静電容量の減少率（％）を算出したところ、20％を
- 20 越えていた。

- 実施例1ないし4ならびに比較例1および2から、粘着層の厚さが0.3 μm 以下であるときは、静電容量の低下は小さく、許容範囲内であるが、粘着層の厚さが0.3 μm を越えると、静電容量が大きく
- 25 低下することが判明した。

- これは、粘着層の厚さが0.3 μm 以下であるときは、粘着層の存在に起因して、積層セラミックコンデンサ中に形成される間隙が小さいのに対し、粘着層の厚さが0.3 μm を越えると、粘着層の存在に起因して、積層セラミックコンデンサ中に形成される間隙が大きくなるためと考えられる。
- 30

本発明は、以上の実施態様に限定されることなく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲内で種々の変更が可能であり、それらも本発明の範囲内に包含されるものであることはいうまでもない。

- たとえば、前記実施態様においては、積層体ユニット 20 の第二の
- 5 支持シート 4 と剥離層 5 との間の接着強度が、5 ないし 20 mN/cm になるように、第二の支持シート 4 の表面に、剥離層 5 が形成され、粘着層 27 と支持体 28 との間の接着強度が、20 ないし 350 mN/cm で、かつ、粘着層 27 と積層体ユニット 20 のセラミックグリーンシート 2 との間の接着強度が、350 mN/cm 以上になるよう
- 10 に、支持体 28 の表面に、粘着層 27 が形成されているが、粘着層 27 と支持体 28 との間の接着強度が、積層体ユニット 20 の第二の支持シート 4 と剥離層 5 との間の接着強度よりも強く、かつ、粘着層 27 と積層体ユニット 20 のセラミックグリーンシート 2 との間の接着強度よりも弱くなるように、粘着層 27 が支持体 28 の表面に形成さ
- 15 れていれば足り、積層体ユニット 20 の第二の支持シート 4 と剥離層 5 との間の接着強度が、5 ないし 20 mN/cm になるように、第二の支持シート 4 の表面に、剥離層 5 が形成され、粘着層 27 と支持体 28 との間の接着強度が、20 ないし 350 mN/cm で、かつ、粘着層 27 と積層体ユニット 20 のセラミックグリーンシート 2 との間の
- 20 の接着強度が、350 mN/cm 以上になるように、支持体 28 の表面に、粘着層 27 が形成されていることは必ずしも必要でない。

- また、前記実施態様においては、第三の支持シート 9 に形成された接着層 10 を、第二の支持シート 4 上に形成された電極層 6 およびスペーサ層 7 の表面に接着し、接着層 10 から、第三の支持シート 9 を
- 25 剥離した後に、接着層 10 を介して、セラミックグリーンシート 2 と、電極層 6 およびスペーサ層 7 とを接着して、積層体ユニット 20 を作製しているが、第三の支持シート 9 に形成された接着層 10 を、第二の支持シート 4 に形成された電極層 6 およびスペーサ層 7 の表面に接着し、接着層 10 から、第三の支持シート 9 を剥離した後に、接着層
- 30 10 を介して、セラミックグリーンシート 2 と、電極層 6 およびスペー

一サ層 7 とを接着して、積層体ユニット 20 を作製することは必ずしも必要でなく、電極層 6 およびスペーサ層 7 が乾燥した後、誘電体ペーストを、電極層 6 およびスペーサ層 7 の表面に塗布して、セラミックグリーンシート 2 を形成するようにしてもよく、あるいは、第一の
5 支持シート 1 上に形成されたセラミックグリーンシート 2 の表面に、電極ペーストを印刷して、電極層 6 を形成し、誘電体ペーストを印刷して、スペーサ層 7 を形成するようにしてもよい。

さらに、前記実施態様においては、剥離層 5 の表面に、電極層 6 およびスペーサ層 7 を、 $t_s / t_e = 1.1$ となるように形成している
10 (t_s はスペーサ層 7 の厚さであり、 t_e は電極層 6 の厚さである。)が、 $0.7 \leq t_s / t_e \leq 1.3$ となるように、好ましくは、 $0.8 \leq t_s / t_e \leq 1.1$ 、さらに好ましくは、 $0.9 \leq t_s / t_e \leq 1.1$ となるように、電極層 6 およびスペーサ層 7 を形成すればよく、電極層 6 およびスペーサ層 7 を、 $t_s / t_e = 1.1$ となるように形成
15 することは必ずしも必要でない。

また、前記実施態様においては、剥離層 5 の表面に、電極層 6 およびスペーサ層 7 が形成されているが、剥離層 5 の表面に、電極層 6 およびスペーサ層 7 を形成することは必ずしも必要でなく、スペーサ層 7 を形成することなく、電極層 6 のみを剥離層 5 上に形成するように
20 してもよい。

さらに、前記実施態様においては、接着層 10 は、帯電防止剤を含んでいるが、接着層 10 が帯電防止剤を含んでいることは必ずしも必要でない。

また、前記実施態様においては、粘着層 27 が、0.01 重量%ないし 15 重量%のイミダゾリン系界面活性剤を含んでいるが、粘着層
25 27 が、0.01 重量%ないし 15 重量%のイミダゾリン系界面活性剤を含んでいることは必ずしも必要でなく、粘着層 27 が、ポリアルキレングリコール誘導体系界面活性剤、カルボン酸アミジン塩系界面活性剤などの他の両性界面活性剤を含んでいてもよく、両性活性剤以
30 外の帯電防止剤を含んでいてもよいし、粘着層 27 が、帯電防止剤を

含んでいなくてもよい。

- さらに、前記実施態様においては、第 6 図に示された接着装置を用いて、セラミックグリーンシート 2 を、接着層 10 を介して、電極層 6 およびスペーサ層 7 の表面に接着させ、しかる後に、第一の支持シート 1 をセラミックグリーンシート 2 から剥離しているが、第 5 図に示された接着・剥離装置を用いて、セラミックグリーンシート 2 を、接着層 10 を介して、電極層 6 およびスペーサ層 7 の表面に接着させるとともに、セラミックグリーンシート 2 から、第一の支持シート 1 を剥離するようにしてもよい。
- 10 本発明によれば、セラミックグリーンシートと電極層を含む積層体ユニットの損傷を確実に防止しつつ、効率的に、所望の数の積層体ユニットを積層して、積層セラミック電子部品を製造することができる積層セラミック電子部品の製造方法を提供することが可能になる。

請求の範囲

1. 支持シート上に、剥離層、電極層およびセラミックグリーンシートが、この順に、積層された複数の積層体ユニットを積層して、積層セラミック電子部品を製造する方法であって、支持体との間の接着強度が、前記支持シートと前記剥離層との間の接着強度よりも強く、かつ、それと前記セラミックグリーンシートとの間の接着強度よりも弱くなるように、前記支持体の表面に形成された粘着層の表面に、前記積層体ユニットの前記セラミックグリーンシートの表面が接触するように、前記積層体ユニットを位置決めして、加圧し、前記支持体上に、前記積層体ユニットを積層することを特徴とする積層セラミック電子部品の製造方法。
2. 前記粘着層が、 $0.01\mu\text{m}$ ないし $0.3\mu\text{m}$ の厚さを有することを特徴とする請求の範囲第1項に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。
3. 前記粘着層が、前記セラミックグリーンシートに含まれているバインダと同系のバインダを含んでいることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。
4. 前記粘着層が、前記セラミックグリーンシートに含まれているバインダと同系のバインダを含んでいることを特徴とする請求の範囲第2項に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。
5. 前記粘着層が、前記セラミックグリーンシートに含まれている可塑剤と同系の可塑剤を含んでいることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。
6. 前記粘着層が、前記セラミックグリーンシートに含まれている可

塑剤と同系の可塑剤を含んでいることを特徴とする請求の範囲第2項に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。

7. 前記粘着層が、前記セラミックグリーンシートに含まれている誘電体と同一組成の誘電体を含んでいることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。

8. 前記粘着層が、前記セラミックグリーンシートに含まれている誘電体と同一組成の誘電体を含んでいることを特徴とする請求の範囲第2項に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。

9. 前記粘着層が、前記バインダよりも少ない割合で、両性界面活性剤を含んでいることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。

10. 前記粘着層が、前記バインダよりも少ない割合で、両性界面活性剤を含んでいることを特徴とする請求の範囲第2項に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。

11. 前記支持体が、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポリフェニレンエーテルおよびポリエチレンテレフタレートよりなる群から選ばれるプラスチック材料によって形成されたことを特徴とする請求の範囲第1項に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。

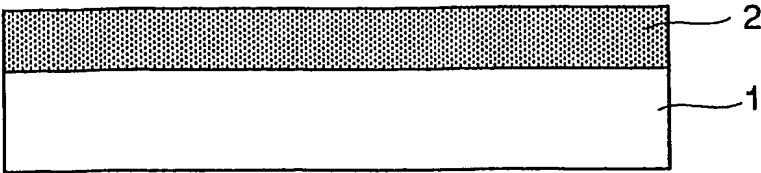
12. 前記支持体が、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポリフェニレンエーテルおよびポリエチレンテレフタレートよりなる群から選ばれるプラスチック材料によって形成されたことを特徴とする請求の範囲第2項に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。

13. 前記セラミックグリーンシートが、 $3\ \mu\text{m}$ 以下の厚さを有することを特徴とする請求の範囲第1項に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。
- 5
14. 前記セラミックグリーンシートが、 $3\ \mu\text{m}$ 以下の厚さを有することを特徴とする請求の範囲第2項に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。
- 10
15. 前記支持体上に積層された積層体ユニットの前記剥離層から、前記支持シートを剥離し、さらに、前記セラミックグリーンシートの表面に、接着層が形成された積層体ユニットを、前記支持体上に積層された積層体ユニットの前記剥離層上に、前記接着層を介して、積層することを特徴とする請求の範囲第1項に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。
- 15
16. 前記支持体上に積層された積層体ユニットの前記剥離層から、前記支持シートを剥離し、さらに、前記セラミックグリーンシートの表面に、接着層が形成された積層体ユニットを、前記支持体上に積層された積層体ユニットの前記剥離層上に、前記接着層を介して、積層することを特徴とする請求の範囲第2項に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。
- 20
17. 前記積層体ユニットが、前記剥離層の表面に、前記電極層のパターンと相補的なパターンで形成されたスペーサ層を備えていることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。
- 25
18. 前記積層体ユニットが、前記剥離層の表面に、前記電極層のパターンと相補的なパターンで形成されたスペーサ層を備えていること
- 30

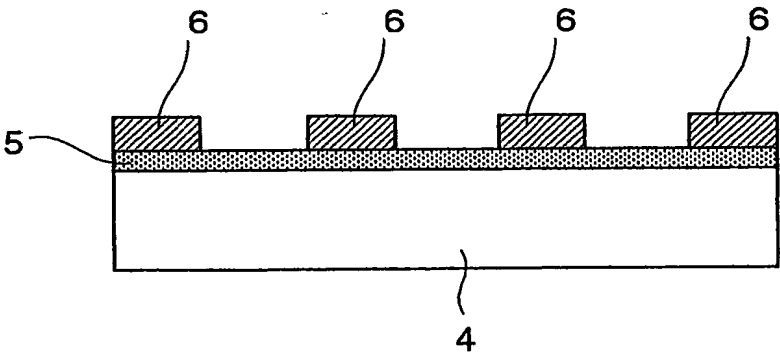
を特徴とする請求の範囲第 2 項に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。

1 / 1 1

第 1 図

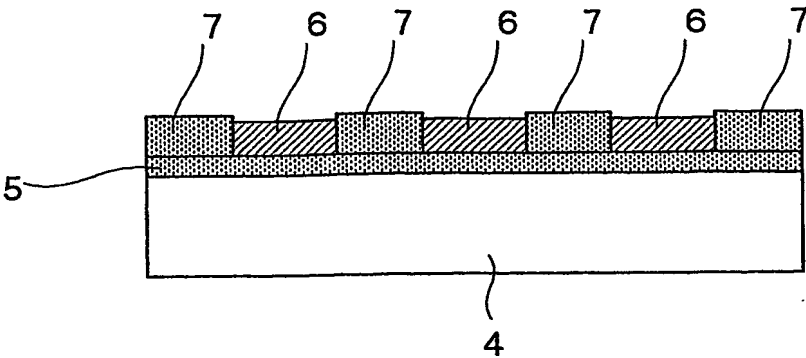


第 2 図

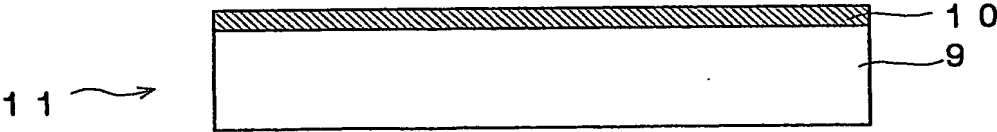


2 / 1 1

第 3 図

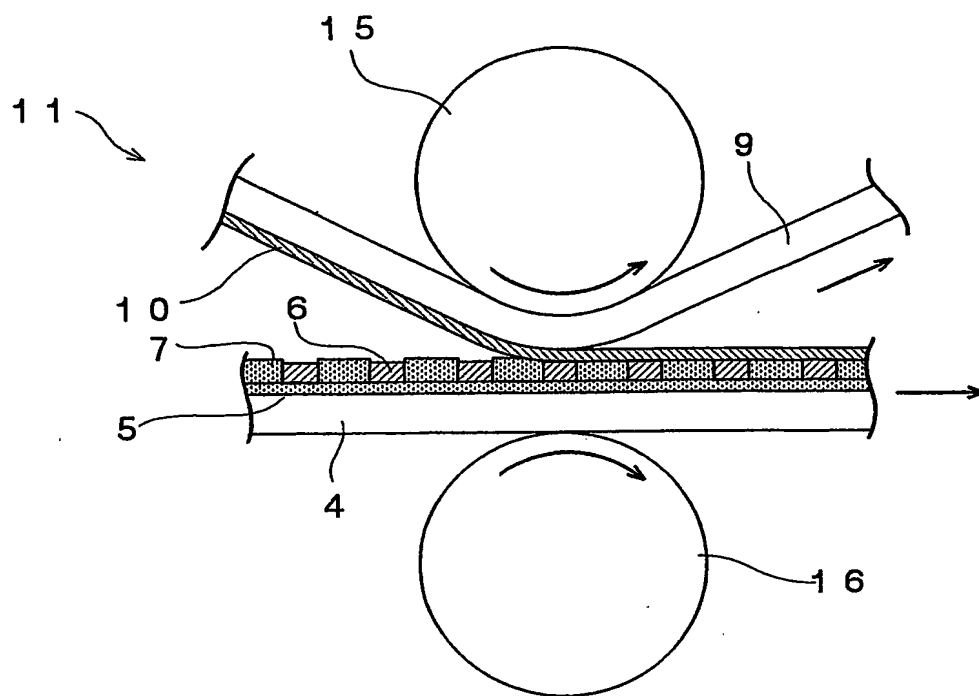


第 4 図



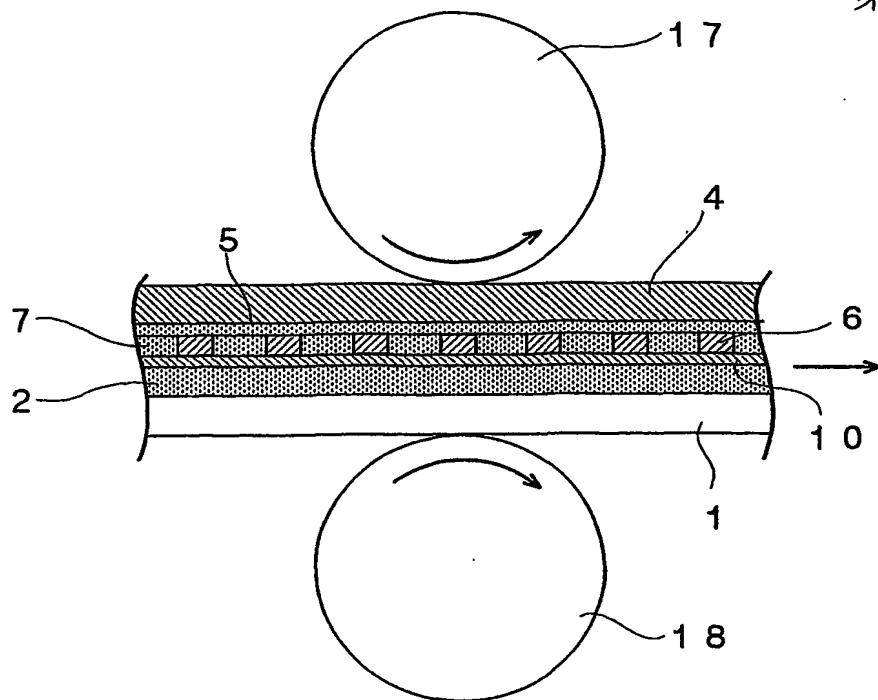
3 / 1 1

第 5 図

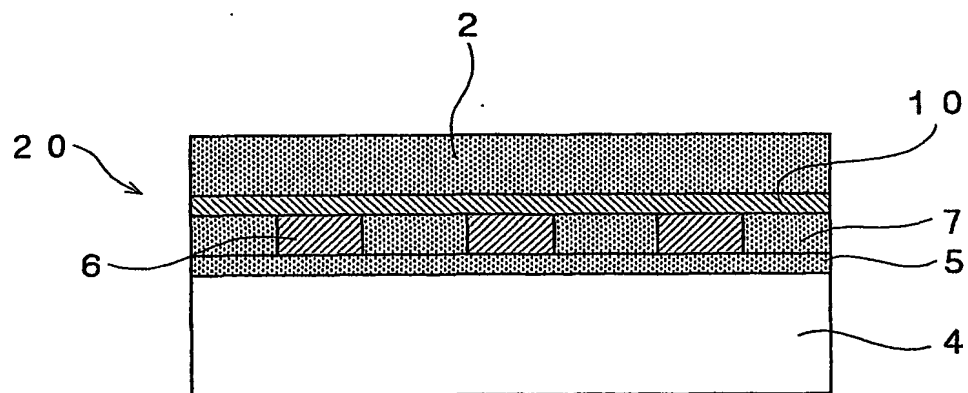


4 / 1 1

第 6 図

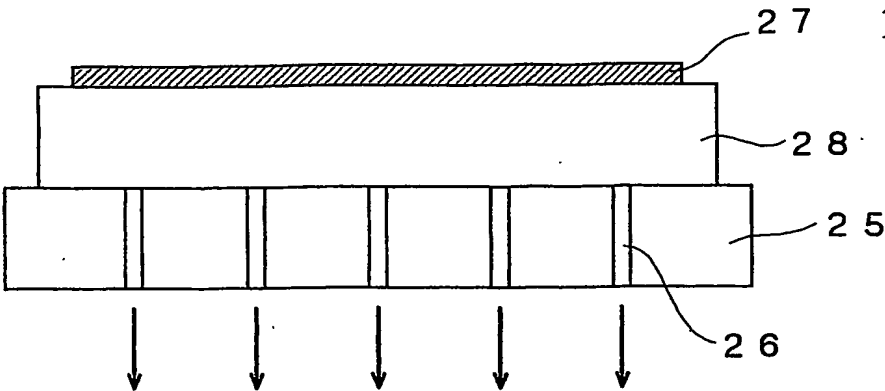


第 7 図

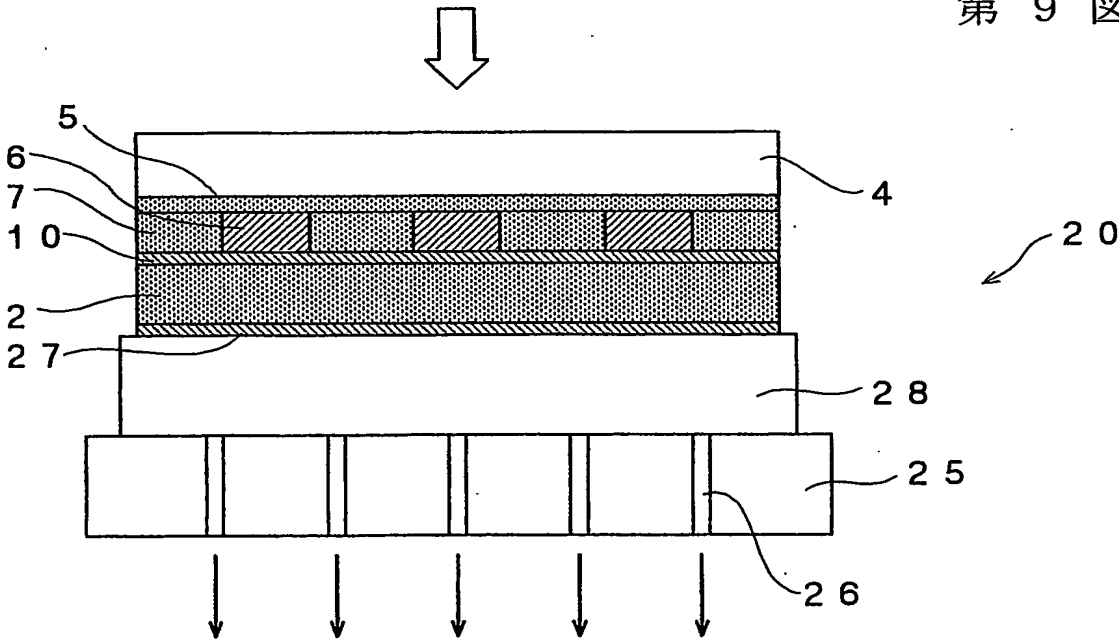


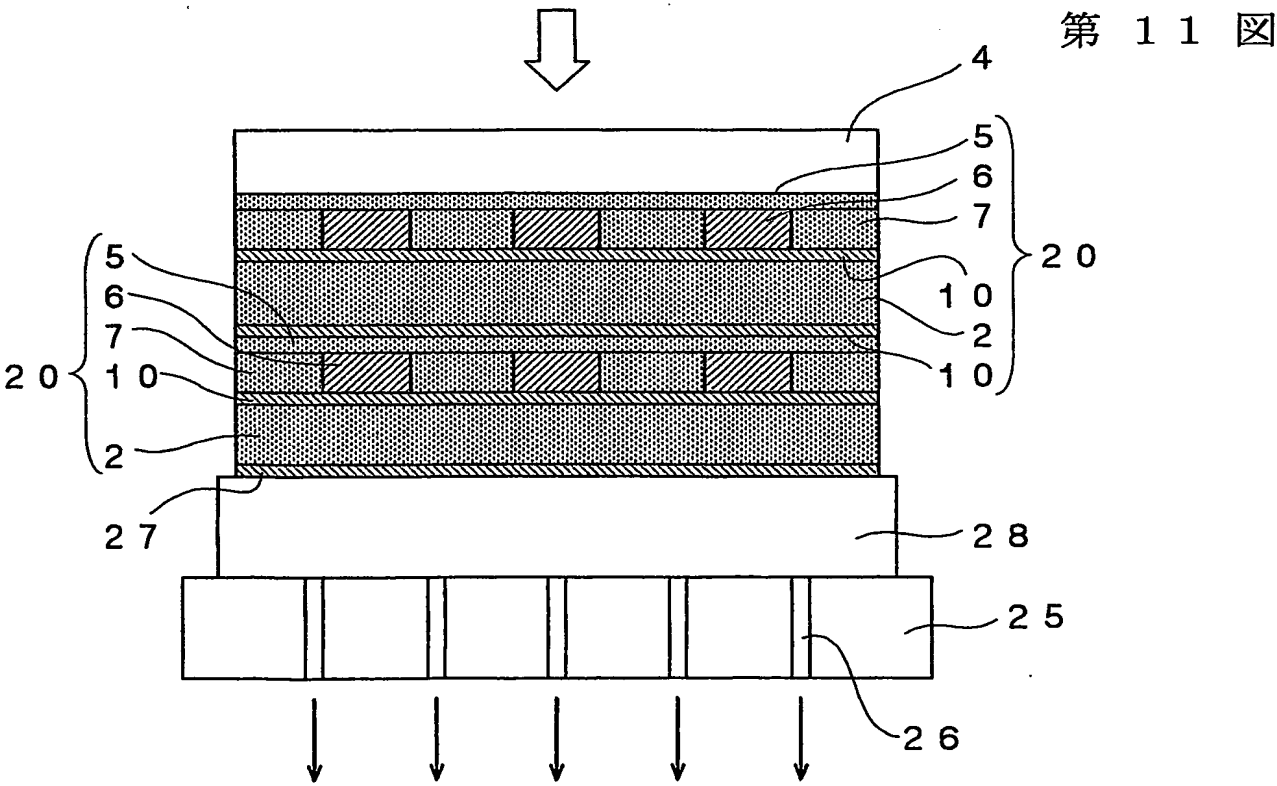
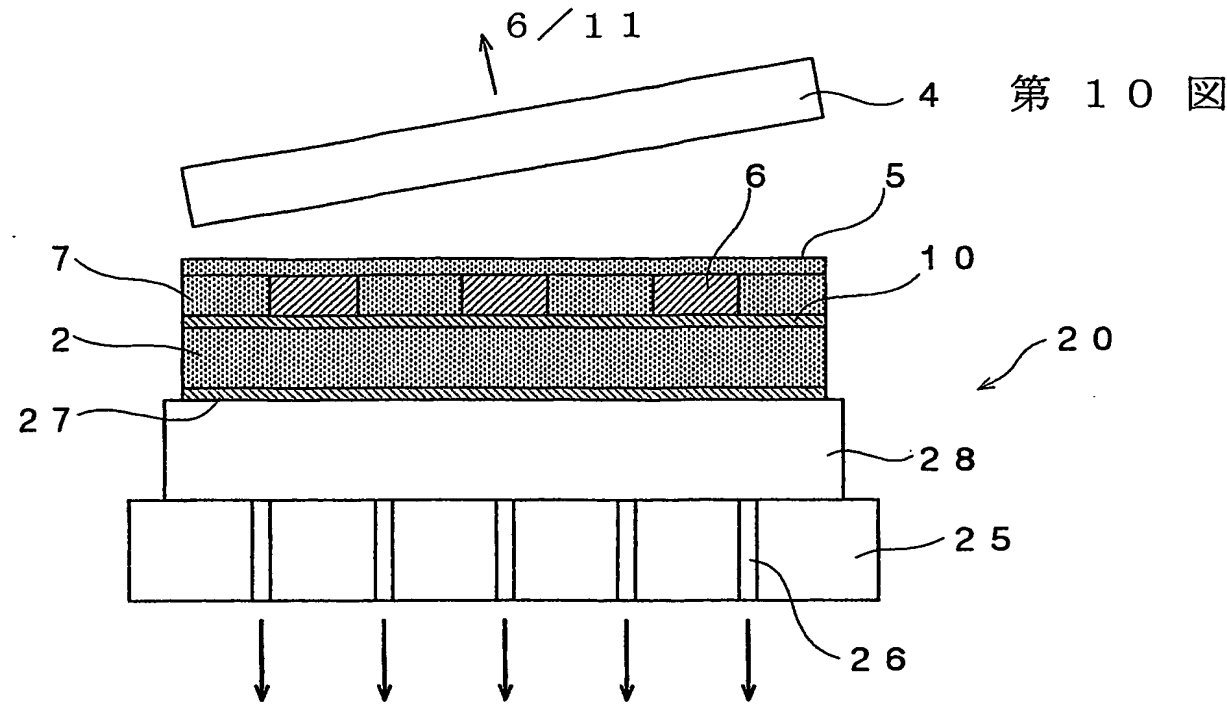
5 / 11

第 8 図



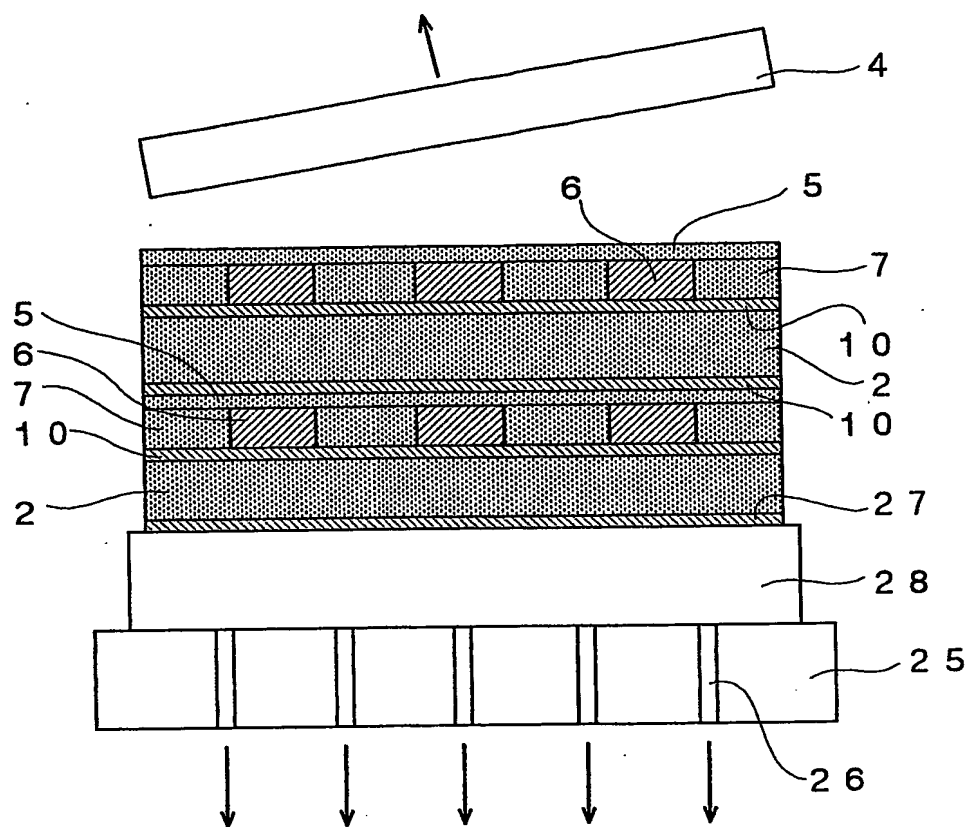
第 9 図





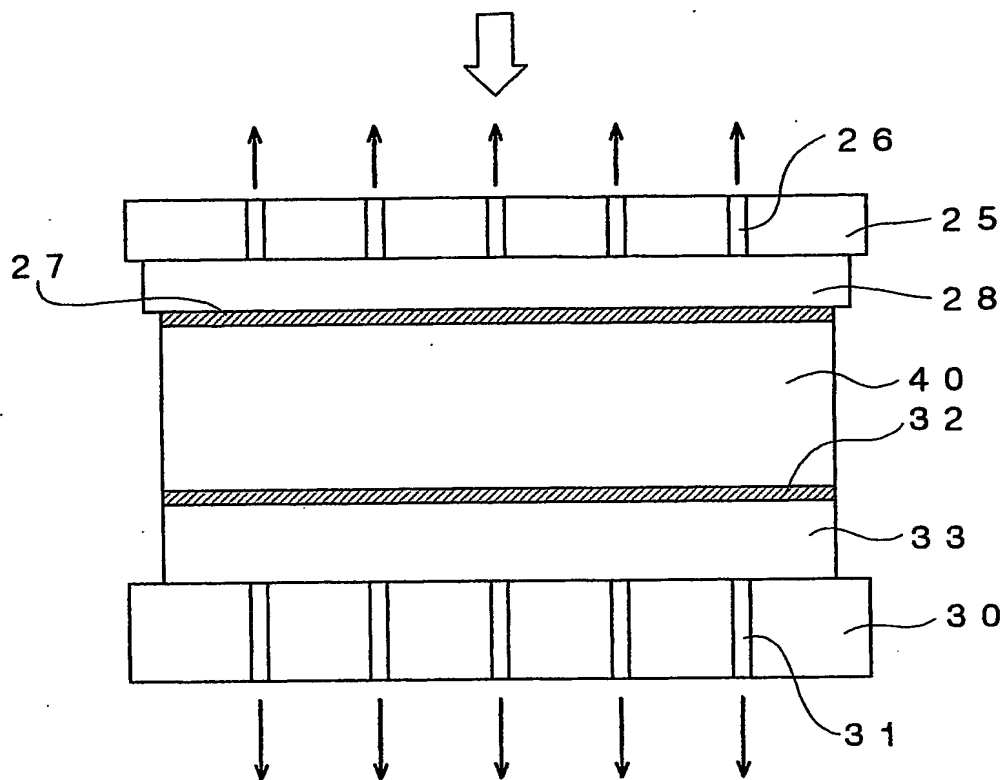
7 / 1 1

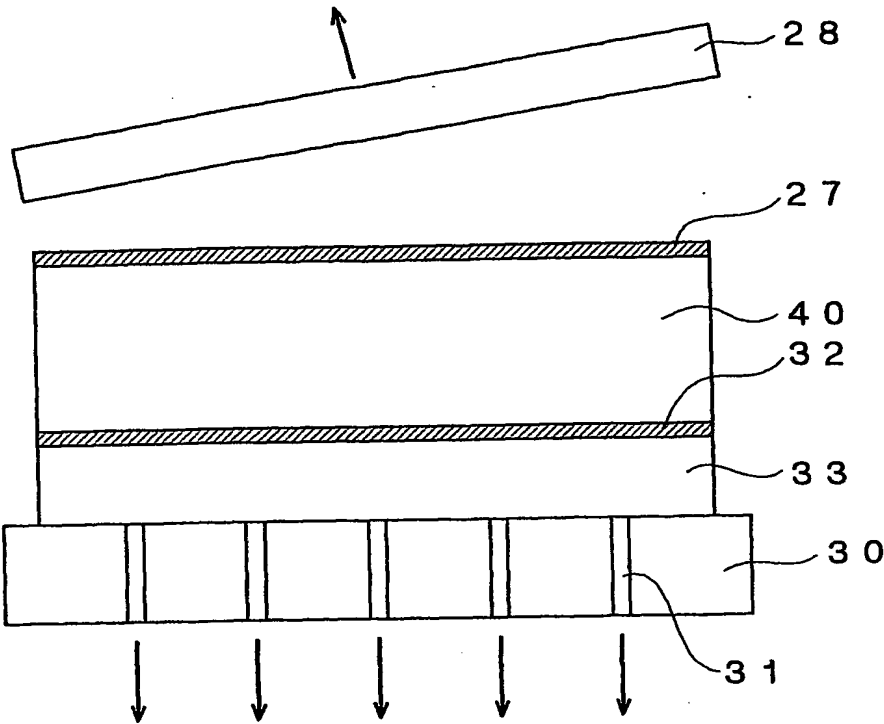
第 1 2 図

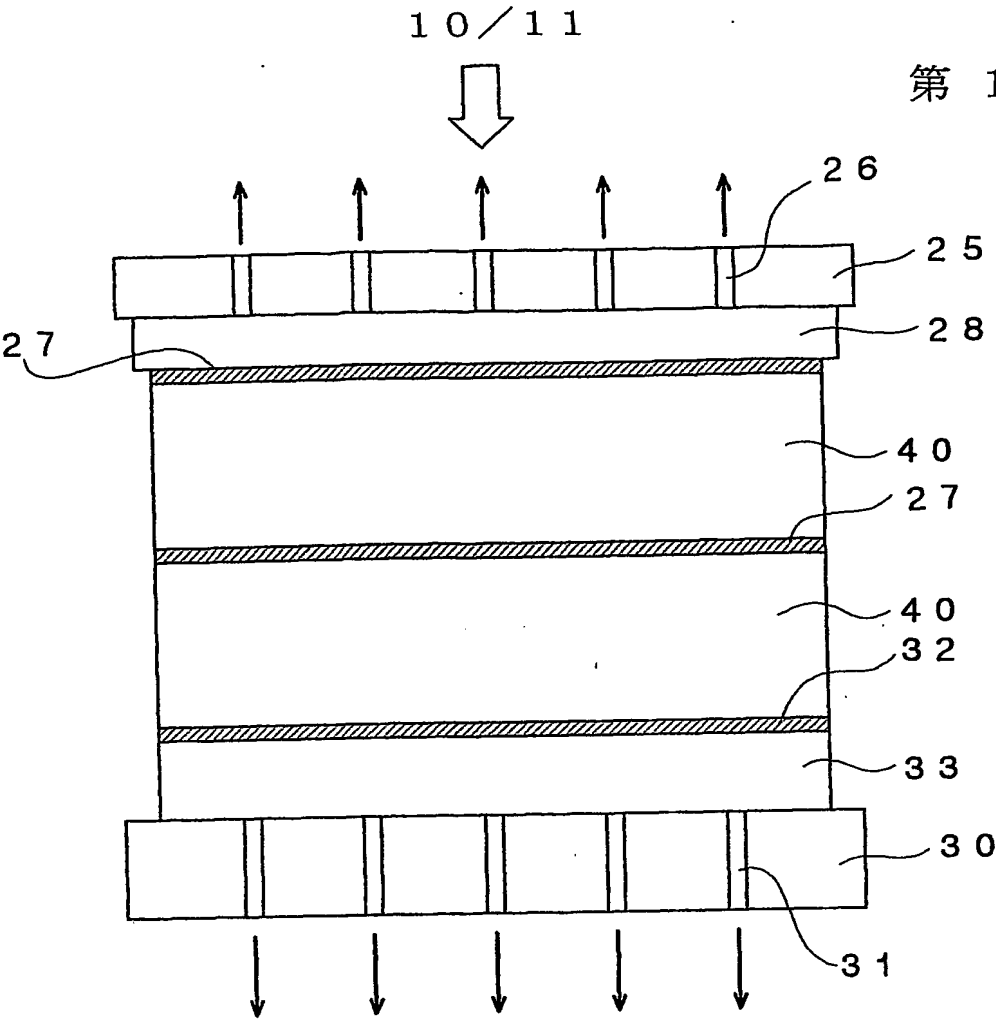


8 / 11

第 13 図

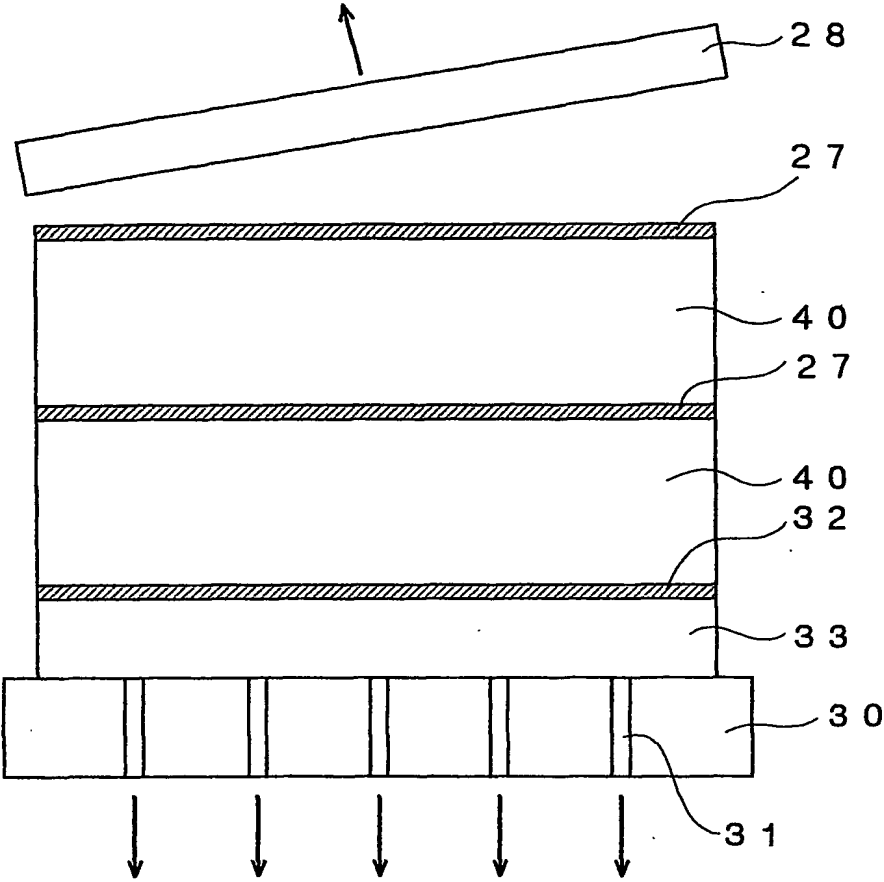






1 1 / 1 1

第 1 6 図



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/004730

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ H01G4/12, 4/30

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
Int.Cl⁷ H01G4/12, 4/30

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2000-315618 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 14 November, 2000 (14.11.00), Par. Nos. [0027] to [0045]; Figs. 1 to 11 (Family: none)	1-18
Y	JP 2002-343674 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 29 November, 2002 (29.11.02), Par. Nos. [0009], [0023], [0024], [0051], [0069]; Figs. 2 to 8 (Family: none)	1-18
Y	JP 11-238646 A (TDK Corp.), 31 August, 1999 (31.08.99), Par. Nos. [0073] to [0076]; Fig. 1 & EP 923094 A2 & US 6550117 B	7,8

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
16 June, 2004 (16.06.04)

Date of mailing of the international search report
06 July, 2004 (06.07.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/004730

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2001-162737 A (Ube Industries, Ltd.), 19 June, 2001 (19.06.01), Par. Nos. [0019] to [0031]; Figs. 1 to 7 (Family: none)	9,10
Y	JP 2001-23853 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 26 January, 2001 (26.01.01), Par. No. [0009] (Family: none)	15,16
Y	JP 2003-59759 A (Murata Mfg. Co., Ltd.), 28 February, 2003 (28.02.03), Par. Nos. [0011] to [0017]; Figs. 1 to 3 (Family: none)	17,18

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP2004/004730

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl. H01G 4/12, 4/30

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl. H01G 4/12, 4/30

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年
 日本国公開実用新案公報 1971-2004年
 日本国登録実用新案公報 1994-2004年
 日本国実用新案登録公報 1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 2000-315618 A (松下電器産業株式会社) 2000. 11. 14, 段落【0027】-【0045】, 図1-11 (ファミリーなし)	1-18
Y	JP 2002-343674 A (松下電器産業株式会社) 2002. 11. 29, 段落【0009】【0023】 【0024】【0051】【0069】, 図2-8 (ファミリーなし)	1-18

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
 「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

16. 06. 2004

国際調査報告の発送日

06. 7. 2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)
 郵便番号100-8915
 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

山田 正文

5R

3387

電話番号 03-3581-1101 内線 3565

C (続き). 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 11-238646 A (ティーディーケイ株式会社) 1999. 08. 31, 段落【0073】-【0076】, 図1 & EP 923094 A2 & US 6550117 B	7、8
Y	JP 2001-162737 A (宇部興産株式会社) 2001. 06. 19, 段落【0019】-【0031】, 図1-7 (ファミリーなし)	9、10
Y	JP 2001-23853 A (松下電器産業株式会社) 2001. 01. 26, 段落【0009】 (ファミリーなし)	15、16
Y	JP 2003-59759 A (株式会社村田製作所) 2003. 02. 28, 段落【0011】-【0017】, 図1-3 (ファミリーなし)	17、18